



2026年3月期 通期 |

決算説明資料

2026年5月14日

マイポックス株式会社

証券コード 5381

イノベーションに 磨きをかける。

イノベーションに磨きをかける。

最先端を研ぎ澄ます。

次の100年を切り開き、世界の常識を塗り替える。

日本には「つゆはらい」という言葉があります。

行列の先を行って障害を取り払うこと。

人々を先導すること。

転じて、何かを最初に行うこと。

お客様が進む未来の先に立ち塞がる課題を、先回りして取り除いておく。

世の中に横たわる課題に、まだ来ない誰かが躓かないように解決しておく。

100年にわたり「塗る・切る・磨く」ソリューションを提供してきた

私たちの仕事は、お客様と社会の行く先に磨きをかけること。

そして皆さんと切磋琢磨しながら、

私たち自身の技術にも磨きをかけることに他なりません。

これからの100年も、

未来が、眩しく光輝くように

私たちは、強く優しく磨き続けます。



商号変更及びコーポレートロゴ刷新

Mipox 株式会社は **マイボックス株式会社** へ。

旧ロゴ・商号

mipox

Mipox株式会社

新ロゴ・商号

◀ MiPOX ▶

マイボックス株式会社

当社は2025年11月21日に創業100周年を迎えました。



これまでの歩みと実績をさらに発展させるべく、2025年10月1日にコーポレートロゴを刷新するとともに、従来の「Mipox株式会社」から、より発音しやすく親しみやすい「マイボックス株式会社」へと商号を変更いたしました。

新ロゴコンセプト「はみ出すことで見える価値」



当社は創業以来100年にわたり、既存の概念にとらわれない姿勢で、常に革新を追求してまいりました。新ロゴは、はみ出すことで新たな価値を発見する当社の挑戦的かつ責任ある姿勢を視覚的に示し、絶え間ないイノベーションへの取り組みを象徴しています。

変わることを忘れない 『100年ベンチャー』

当社は1925年にドイツ・レイポルト商館の子会社として創業し、輸入した顔料を販売する傍ら主に出版物に使われる色箔の製造を生業としておりました。1960年代後半よりこの色箔を製造する中で培った「塗る」技術、それを裁断する「切る」技術を基に、精密部品の製造工程事業に使用される研磨フィルムを開発し、「塗る・切る・磨く」の3つのコア技術を確立いたしました。

精密研磨材専門メーカーとして発展を経て、2000年初頭からはコア技術である『塗る』をサービスとして提供するエンジニアリングサービス（受託塗布）を開始いたしました。創業来の危機である2008～2010年を乗り越えたあとは、『磨く』をサービスとして提供するウエハープロセス（受託研磨）を立ち上げ、「塗る・切る・磨くで世界を変える」に取り組んでまいりました。2016年には研磨布紙メーカーである日本研紙を仲間に加え、製品事業のラインナップの拡充を進めました。

創業から間もなく100年。事業を長く続けていくために、急速に変化するテクノロジーや世の中の価値観を敏感にとらえながら、自らも変化に順応していくことが求められます。こうした時代のニーズに対応するため、わたしたちが培ってきたコア技術をさらに高めながら、新しい事業にも積極的にチャレンジし、世の中に必要とされる製品やサービスを通じて世界のお客様に選ばれるパートナーを目指してまいります。

変わることを忘れない、『100年ベンチャー』を目指してこれからも変化し続ける集団でありつづけます。

今後とも皆様のご愛顧のほど、よろしくお願いいたします。

代表取締役社長 渡邊 淳



Agenda

01

会社概要

Company overview

02

**2026年3月期
通期実績**

FY2026 Full Year Financial Results

03

**2027年3月期
業績見通し**

FY2027 Full Year Forecast

04

事業内容

Our Business

05

競争力の源泉

Competitive Advantage

06

成長戦略

Growth Strategy

07

Appendix

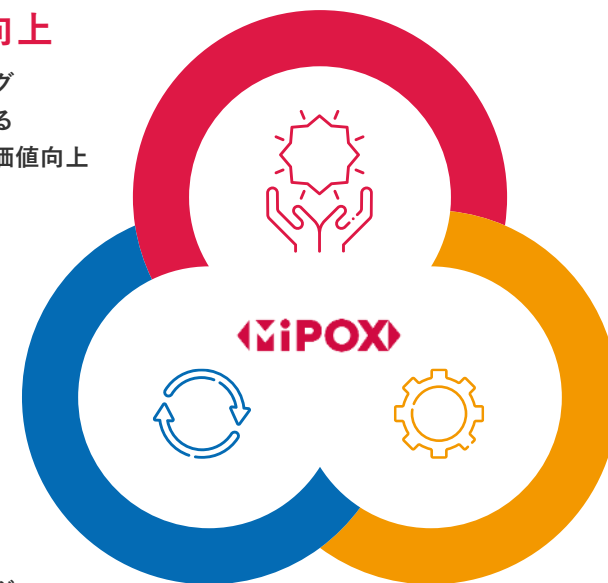
Appendix

会社名	マイボックス株式会社
英文名	Mipox Corporation
創業	大正14年（1925）年11月21日
設立	昭和16年（1941）年12月12日
代表者	代表取締役社長 渡邊 淳
本店・本社	〒322-0014 栃木県鹿沼市さつき町18
株式市場名	東京証券取引所 スタンダード
証券コード	5381

【経営方針】

付加価値向上

エンジニアリング
アプローチによる
製品事業の付加価値向上



事業転換

受託事業から
エンジニアリング
サービス事業への転換

経営基盤の整備

早い変化と
多様性に対応できる
経営基盤の整備



「塗る、切る、磨く」を極めた技術力

創業から続く箔の製造技術を応用することで「塗る」「切る」「磨く」技術をコアにした事業を展開した企業です。
コア技術を組み合わせ、お客様の成功のための付加価値を創造するための製品とサービスを提供します。



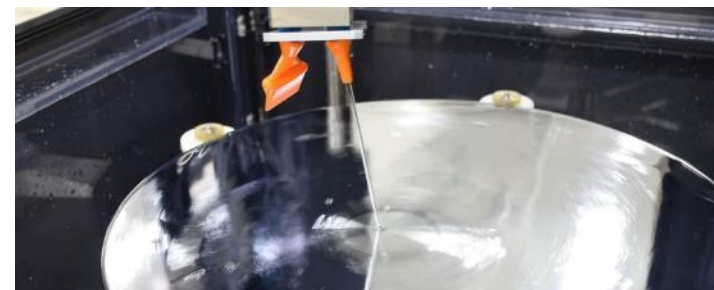
塗る Coating

PETフィルム、銅箔、織布、紙等の基材に、調合した樹脂等の塗料を均一に塗布。
自社製品である研磨材や反射材だけでなく、保有する複数の塗工機によって要望に合わせた機能性フィルムの製造も実現。



切る Slitting

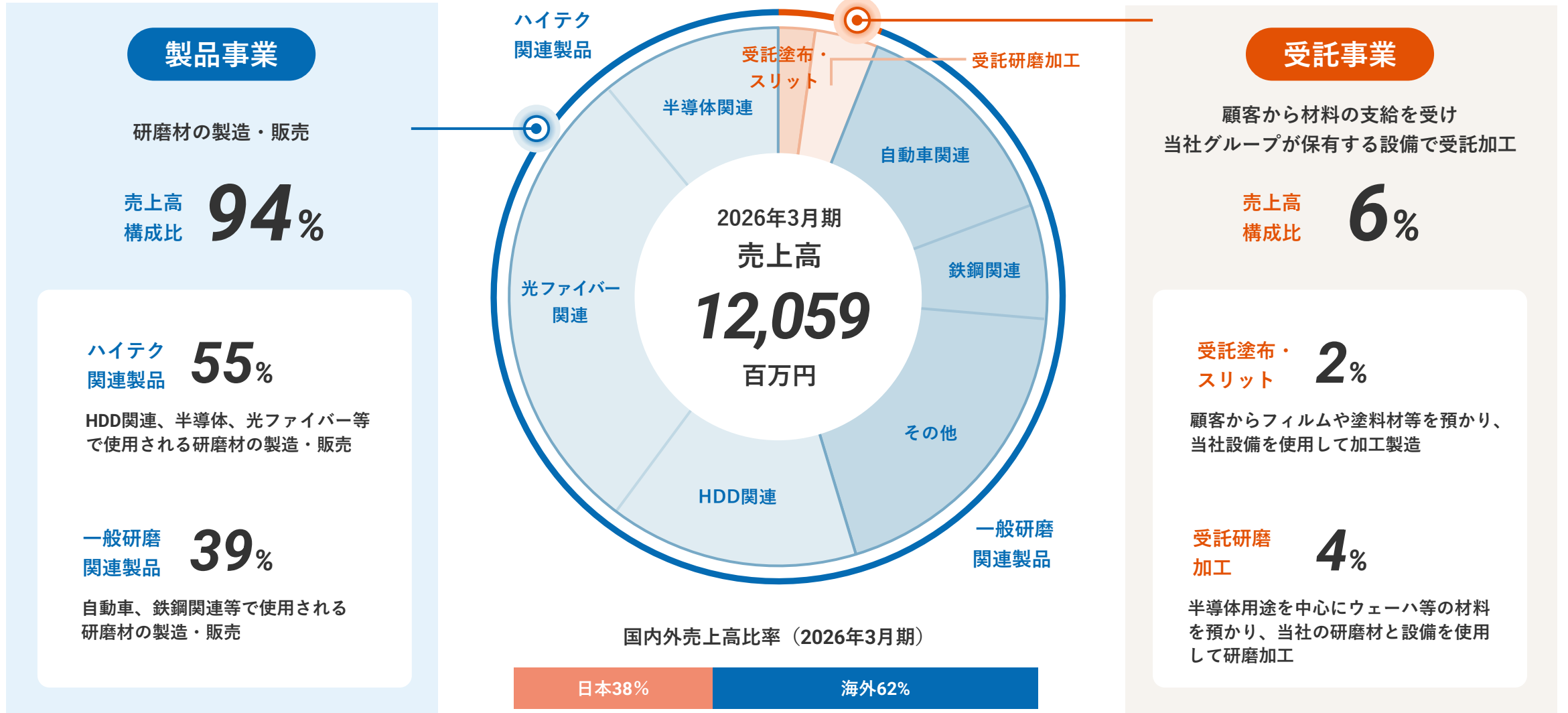
「塗る」ことで出来た製品を希望のサイズに裁断（スリット）。高精密さが求められるハードディスク向け研磨フィルムの製造で培った技術によって、裁断が困難といわれている素材でも精度の高い切り口と巻き上げを実現し、高品質の製品を提供。



磨く Polishing

徹底的な顧客視点を持った製品開発のために自社の研磨材と独自の研磨装置で研磨プロセスの研究を積み重ねる。
ハイテク分野で培った高精度研磨加工技術で次世代半導体ウェーハの研磨にも挑戦し、研磨市場に於けるプロフェッショナルを目指す。

拠点開設		事業領域	売上高 (百万円)		トピックス	
1925	東京都京橋区にて設立	製品事業 受託事業			顔料と色箔の輸入業者としてドイツ資本により設立 (独逸顔料合名会社)	
1981					日本マイクロコーティング(株)へ商号変更	
2001			6,858		JASDAQ店頭市場に上場	
2002			4,439			
2003			4,949			
2004			7,197			
2005			10,799			
2006			8,966			
2007			8,329			
2008			6,083			
2009			3,238		2009年3月期 渡邊淳が代表取締役社長に就任 (現代表)	
2010			3,013		受託事業強化	
2011			3,157			
2012	インド、中国 (上海)		3,045			
2013	フィリピン		2,815	594	3,409	Mipox(株)へ商号変更、本社を東京都立川市へ移転
2014	台湾		3,202	558	3,760	
2015	京都府京都市		3,606	379	3,985	日本レフライト工業(株)を子会社化、Mipox Kyoto(株)を設立
2016	ベトナム、広島県福山市		3,930	274	4,204	日本研紙(株)を子会社化
2017			6,219	190	6,410	Mipox Kyoto(株)を吸収合併
2018			7,009	816	7,826	
2019			7,083	474	7,558	日本研紙(株)の営業機能を統合
2020	中国 (深セン)		6,832	506	7,338	Ref Liteのリブランド
2021	広島県呉市		6,416	944	7,361	本店を山梨県北杜市へ移転、日本研紙(株)を吸収合併、オムニ・カーボナイト事業を吸収分割
2022	栃木県鹿沼市		7,570	2,879	10,449	ミスミ化学(株)を子会社化、本社を東京都四谷に移転
2023			7,948	2,080	10,029	本店本社を栃木県鹿沼市へ移転、(株)スガコーディングスの粉体塗装事業を譲受、(有)大久保鉄工所を子会社化
2024	熊本県熊本市、宮城県仙台市、石川県金沢市	7,618	1,735	9,354	インド工場を移転、thomas (株)への出資	
2025		9,956	1,215	11,172	創業100周年、マイボックス(株)へ商号変更	
2026		11,339	720	12,059		



Agenda

01

会社概要

Company overview

02

2026年3月期
通期実績

FY2026 Full Year Financial Results

03

2027年3月期
業績見通し

FY2027 Full Year Forecast

04

事業内容

Our Business

05

競争力の源泉

Competitive Advantage

06

成長戦略

Growth Strategy

07

Appendix

Appendix

(百万円)	リリース日	売上高	営業利益	経常利益	親会社株主に帰属する 当期純利益
期初予想 (A)	2025年5月15日	11,000	900	1,000	700
修正予想 (B)	2025年11月14日	11,000	600	600	550
2026年3月期実績 (C)	2026年5月14日	12,059	579	613	505
2025年3月期実績		11,172	942	855	911
増減額 (C-B)		+1,059	▲20	+13	▲44
増減率		9.6%	▲3.4%	2.3%	▲8.1%

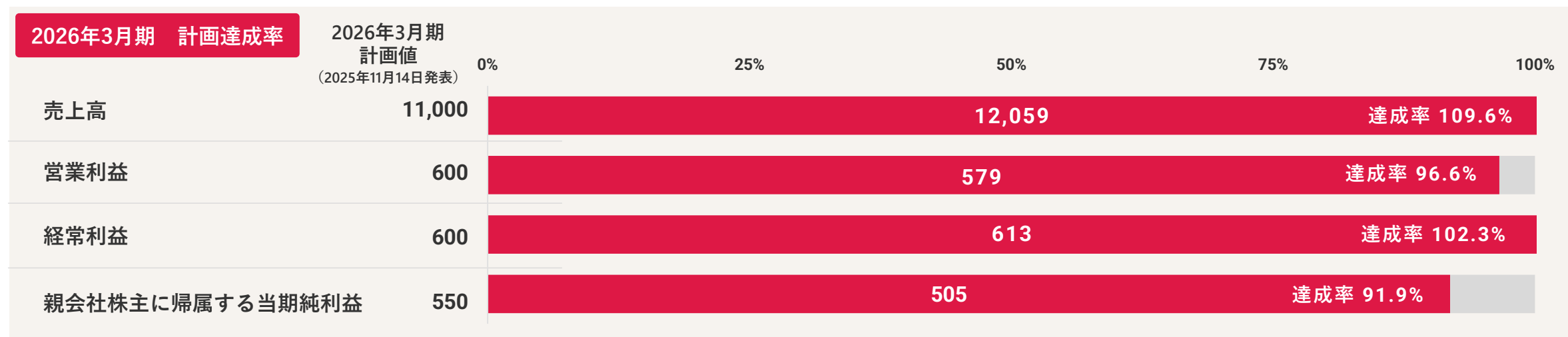
*増減算出後、百万円未満切捨て

【コメント】

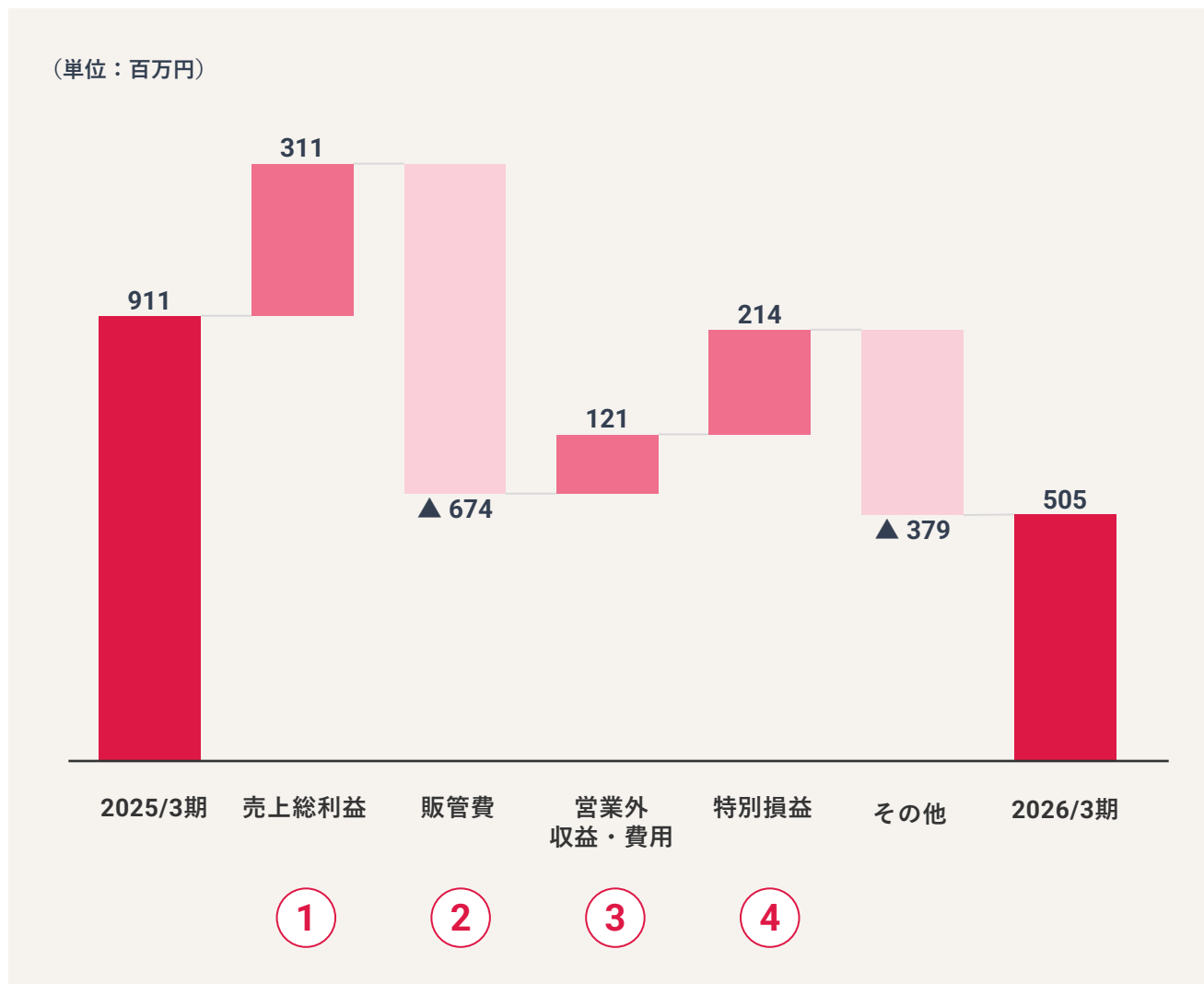
- 米国を中心とする光ネットワークインフラ整備や生成AI関連のデータセンター設備強化の影響により、ハイテク関連製品であるHDD関連や光ファイバー関連の売上高が堅調に推移し、期初予想を上回る売上高水準で着地しました。
- 上期における一時的な輸送コストの影響を踏まえ、第2四半期において業績予想の修正を行いました。営業利益、経常利益および親会社株主に帰属する当期純利益は修正予想に概ね近似する結果となりました。

前年同期と比較し売上高は増加しましたが、販売費及び一般管理費が大きく増加し、営業利益及び親会社株主に帰属する当期純利益は前年同期を下回りました。

(単位：百万円)	2025/3期	2026/3期	前年同期比
売上高	11,172	12,059	7.9%
売上総利益	4,369	4,680	7.1%
販売費及び一般管理費	3,427	4,101	19.7%
営業利益	942	579	▲ 38.5%
為替差損益	▲ 97	30	-
経常利益	855	613	▲ 28.2%
親会社株主に帰属する当期純利益	911	505	▲ 44.5%



*百万円未満切り捨て、業績数値の百万円未満の端数の扱いにより、若干の差異が生じる可能性があります。



*増減算出後、百万円未満切捨て

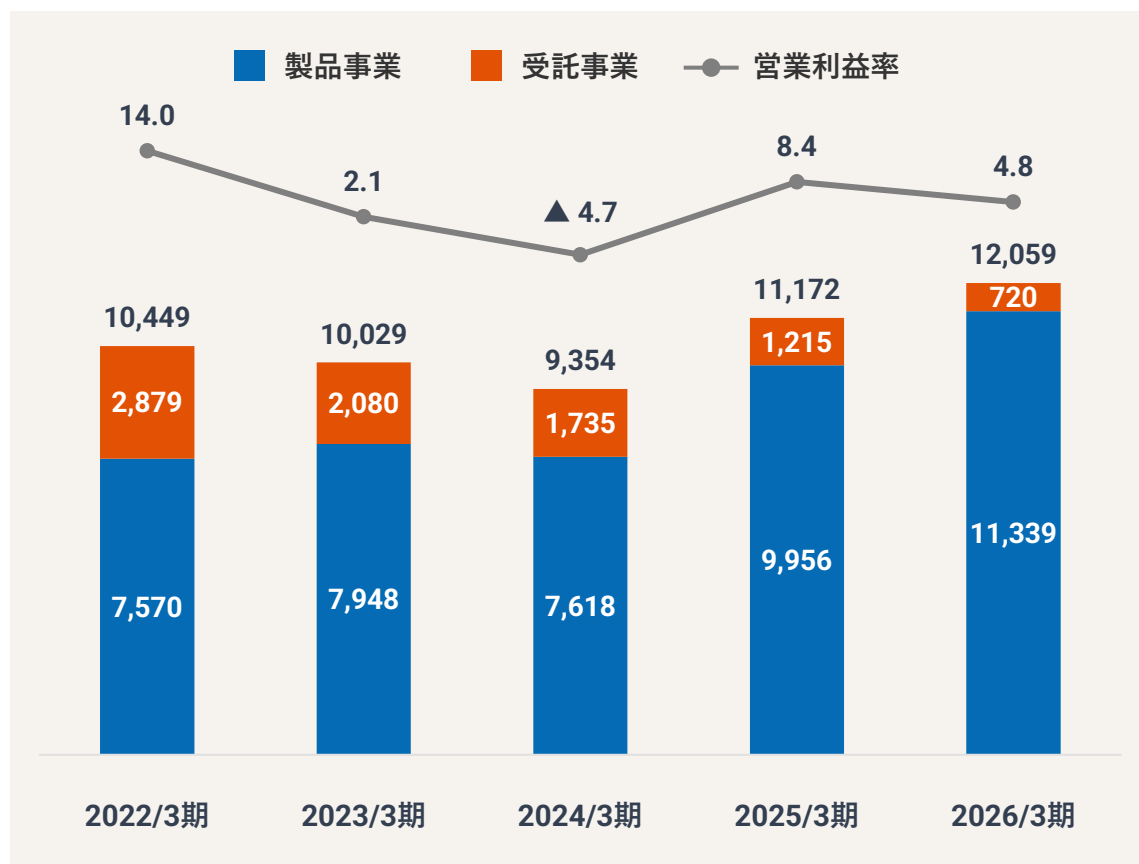
利益増減要因

- ① 売上高が前年同期比で増加したことにより売上総利益は増加しました。
- ② 人的投資、設備・開発投資、及び一時的な輸送コストの影響を中心に販管費が大幅に増加しました。
- ③ 円安による為替の影響により当期は為替差益が計上されたことで営業外費用が減少しました。
- ④ 子会社化した株式会社ウジケの負ののれん発生益により特別利益が増加しました。

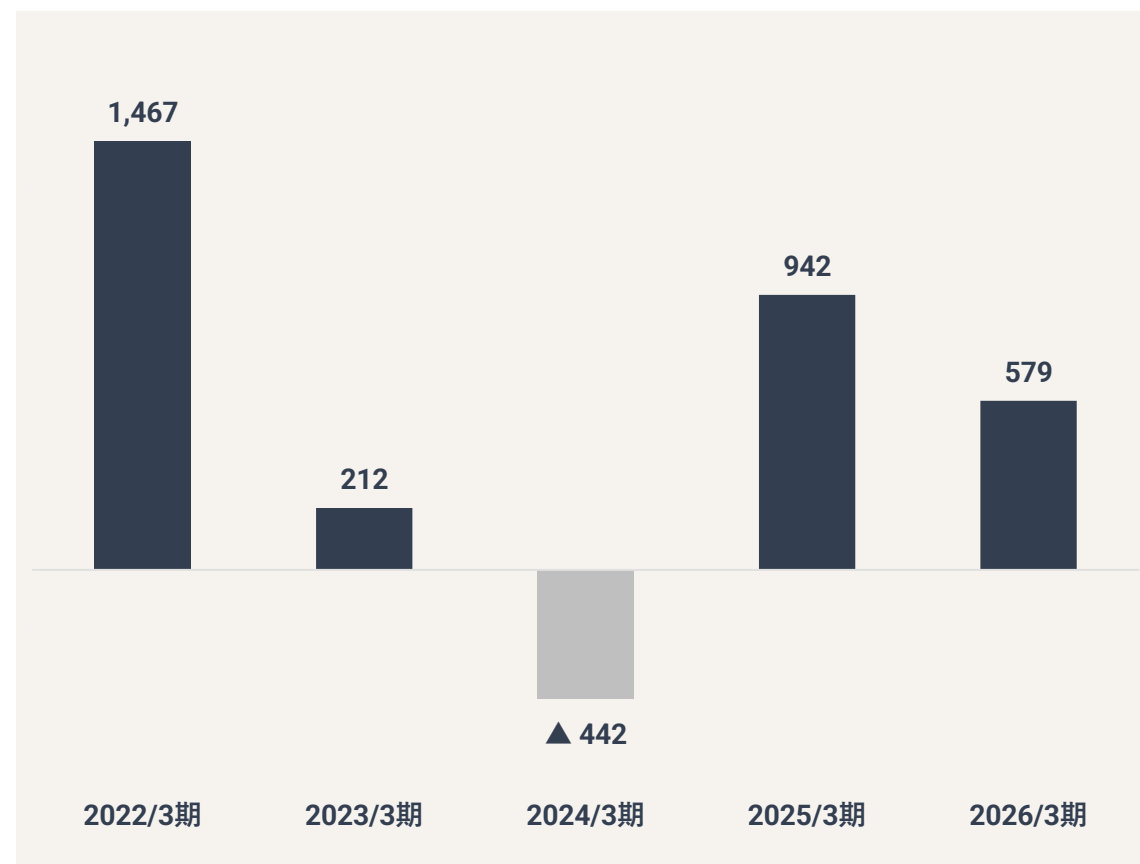
02 通期業績推移（連結）

売上高は製品事業が前期に引き続き堅調に推移している一方、受託事業は前年同期と比べて減少しました。営業利益は、ベースアップによる人件費の増加やJ-ESOP関連費用の計上などの人的投資の他、設備投資や研究開発投資などの投資の影響に加え、一時的な輸送コストの影響等により、前年同期比で減少し、増収減益となりました。

売上高・営業利益率（単位：百万円・%）



営業利益（単位：百万円）

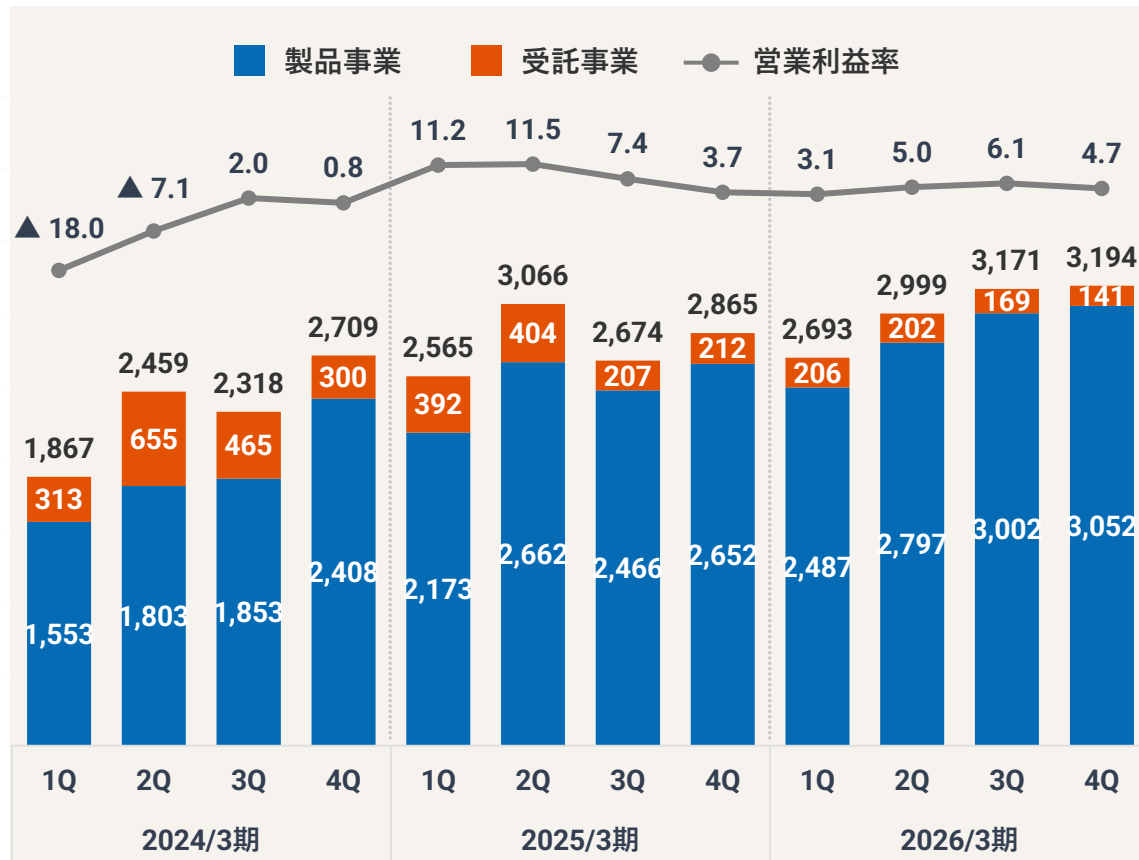


*業績数値の百万円未満の端数の扱いにより、若干の差異が生じる可能性があります。

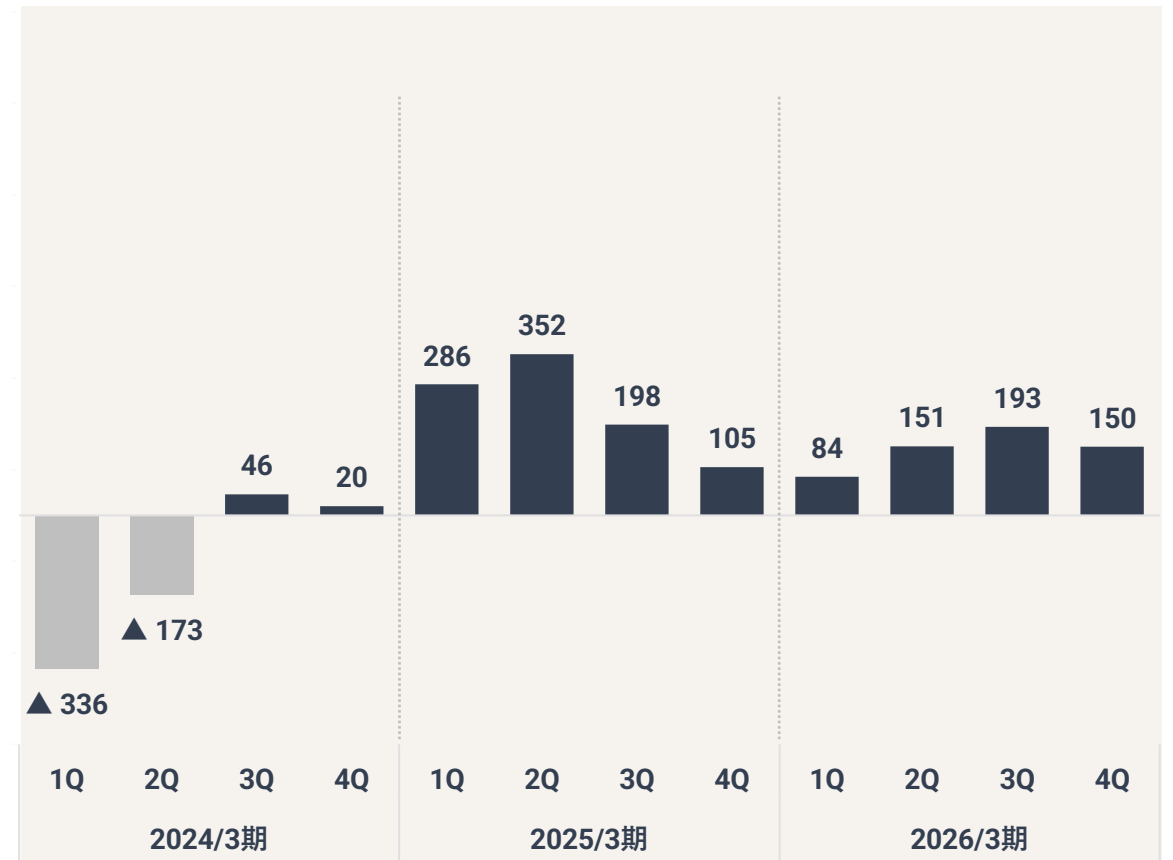
02 四半期業績推移（連結）

ハイテク関連製品を中心に製品事業の売上が好調に推移した影響で、売上高は堅調に推移しました。また、営業利益も各種投資の影響や当第4四半期会計期間に支給する業績を踏まえた賞与支給の影響はあるものの、好調な売上の影響で堅調に推移しました。

売上高・営業利益率（単位：百万円・%）



営業利益（単位：百万円）

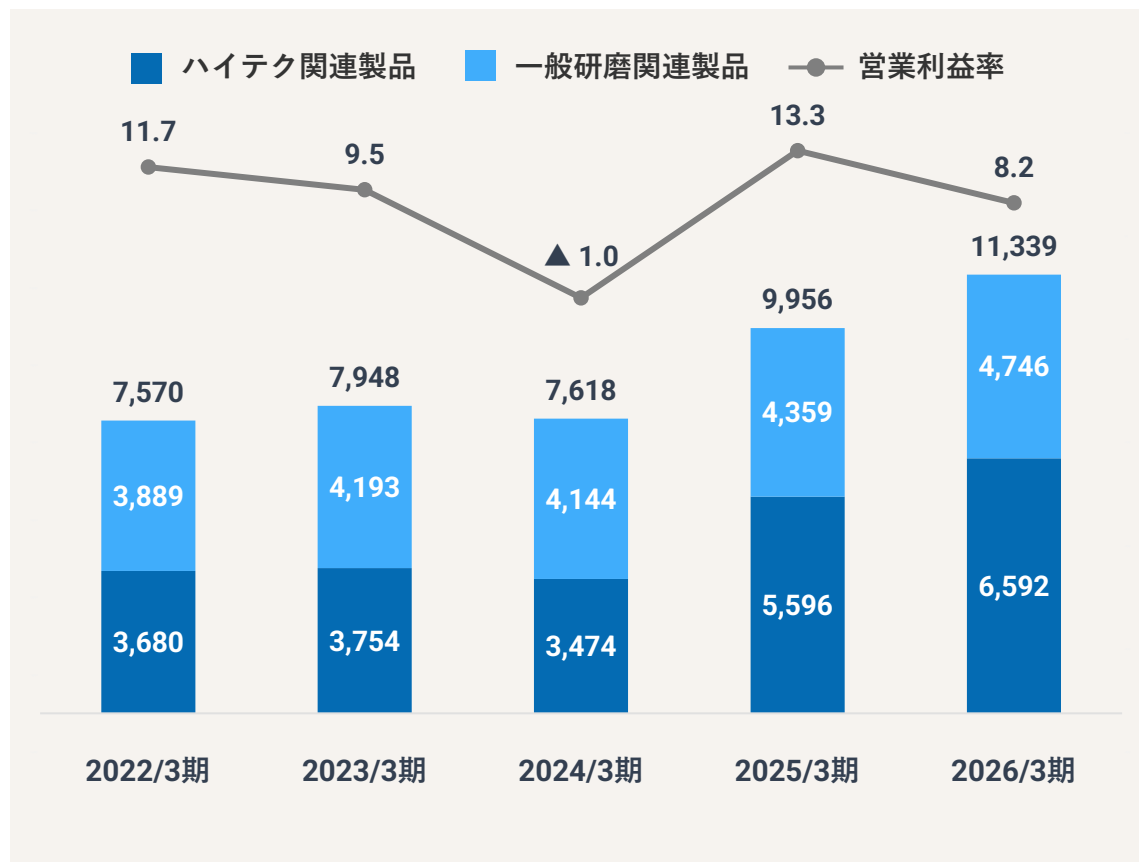


*業績数値の百万円未満の端数の扱いにより、若干の差異が生じる可能性があります。

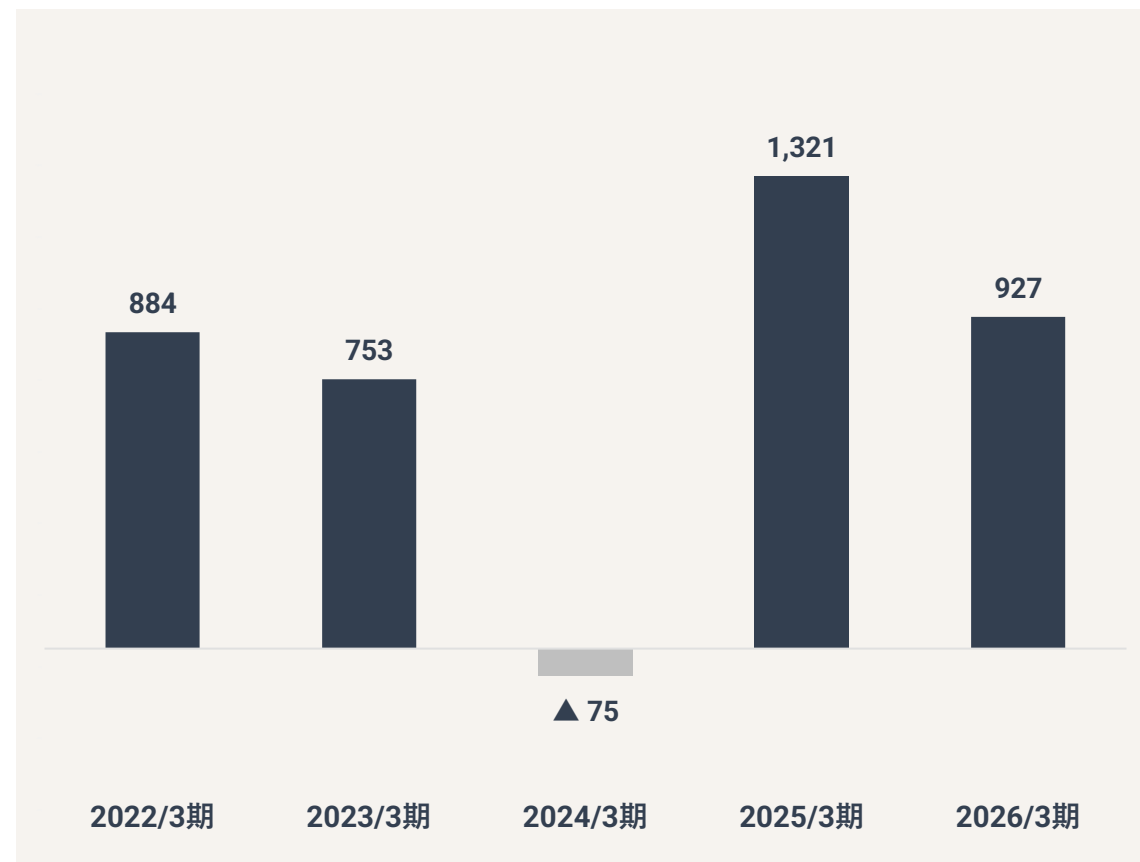
02 通期業績推移（製品事業）

売上高は、ハイテク関連製品は堅調に売上を伸ばし、一般研磨関連製品も安定的に売上が推移しました。セグメント利益は、相対的に利益率の高いハイテク関連製品の売上は増加したものの、各種投資等による販管費の増加及び受託事業の落ち込みによる共通固定費の負担率が上昇したことにより前年同期比で減少し、増収減益となりました。

売上高・営業利益率（単位：百万円・%）



営業利益（単位：百万円）

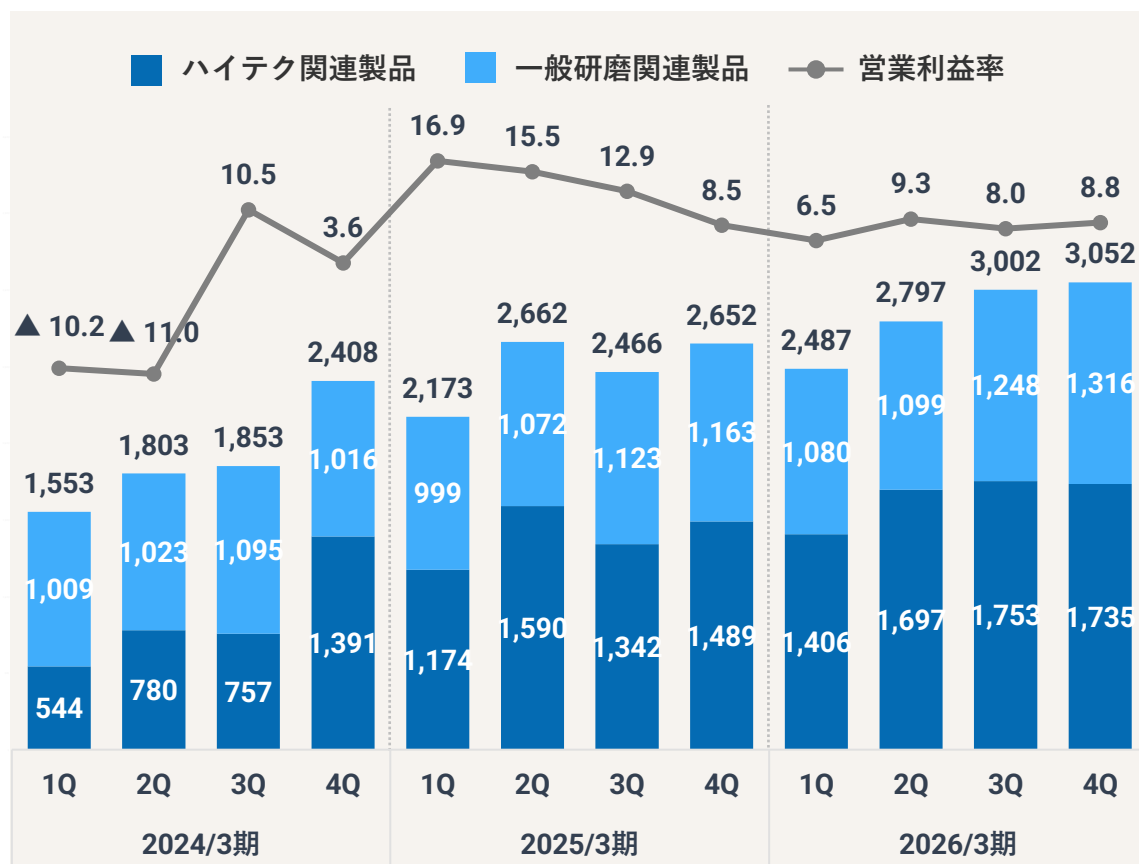


*業績数値の百万円未満の端数の扱いにより、若干の差異が生じる可能性があります。

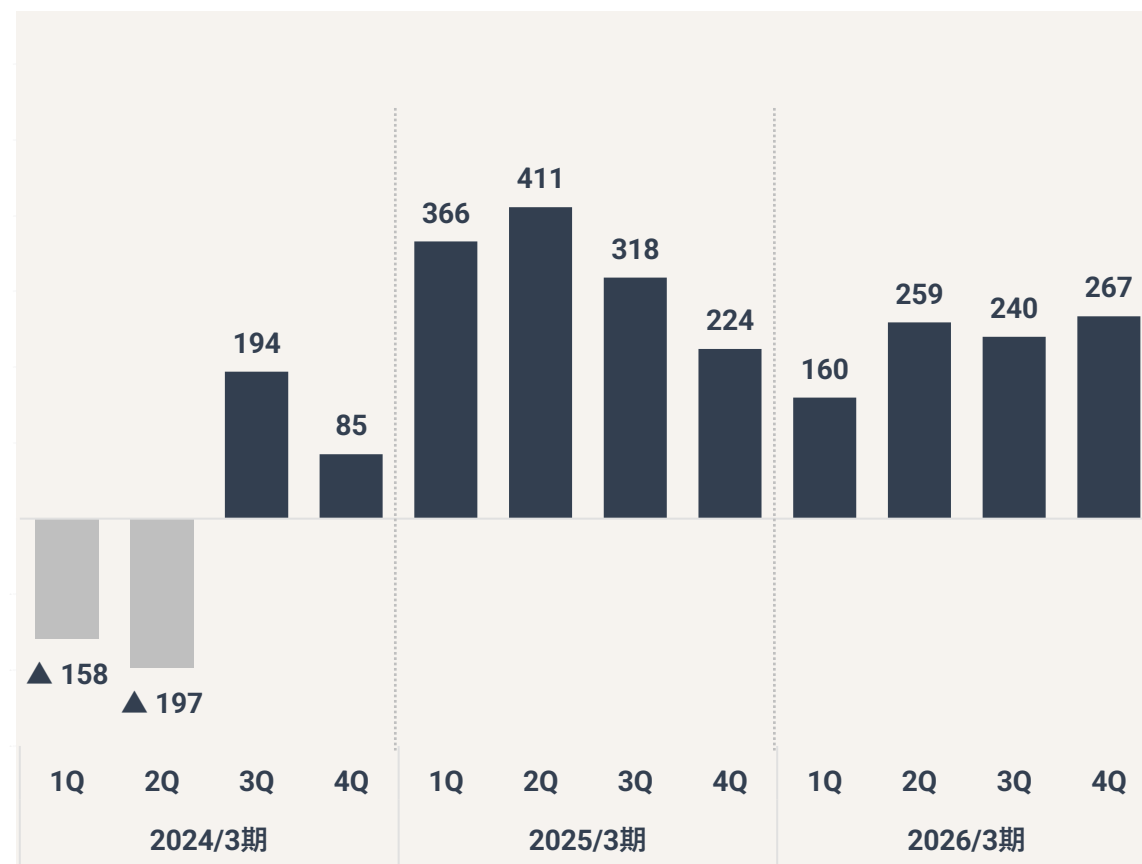
02 四半期業績推移（製品事業）

売上高は、ハイテク関連製品は堅調に売上を伸ばし、一般研磨関連製品も安定的に売上が推移しました。セグメント利益は、各種投資による販管費の増加及び受託事業の落ち込みによる共通固定費の負担増により、通期では前年同期比で減少し増収減益となりました。一方、四半期ベースでは、ハイテク関連製品等の伸長により利益面も上昇傾向で推移しております。

売上高・営業利益率（単位：百万円・%）



営業利益（単位：百万円）

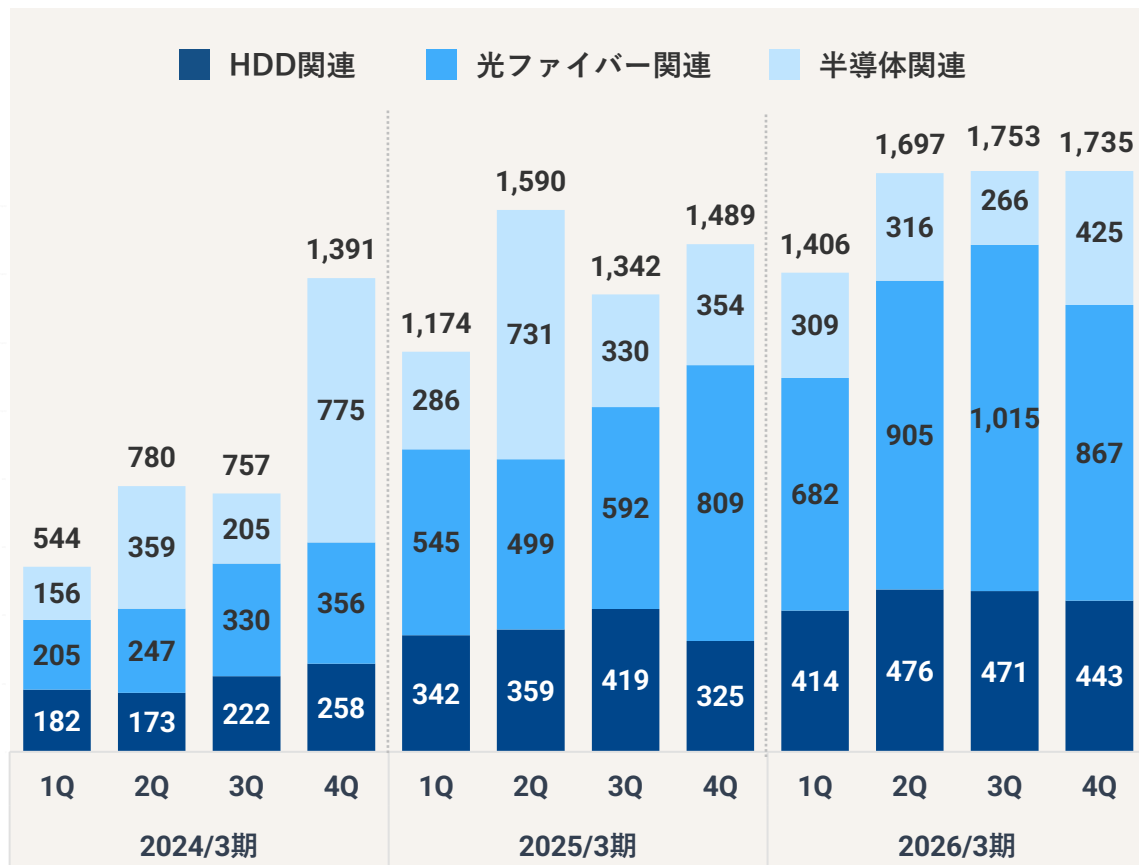


*業績数値の百万円未満の端数の扱いにより、若干の差異が生じる可能性があります。

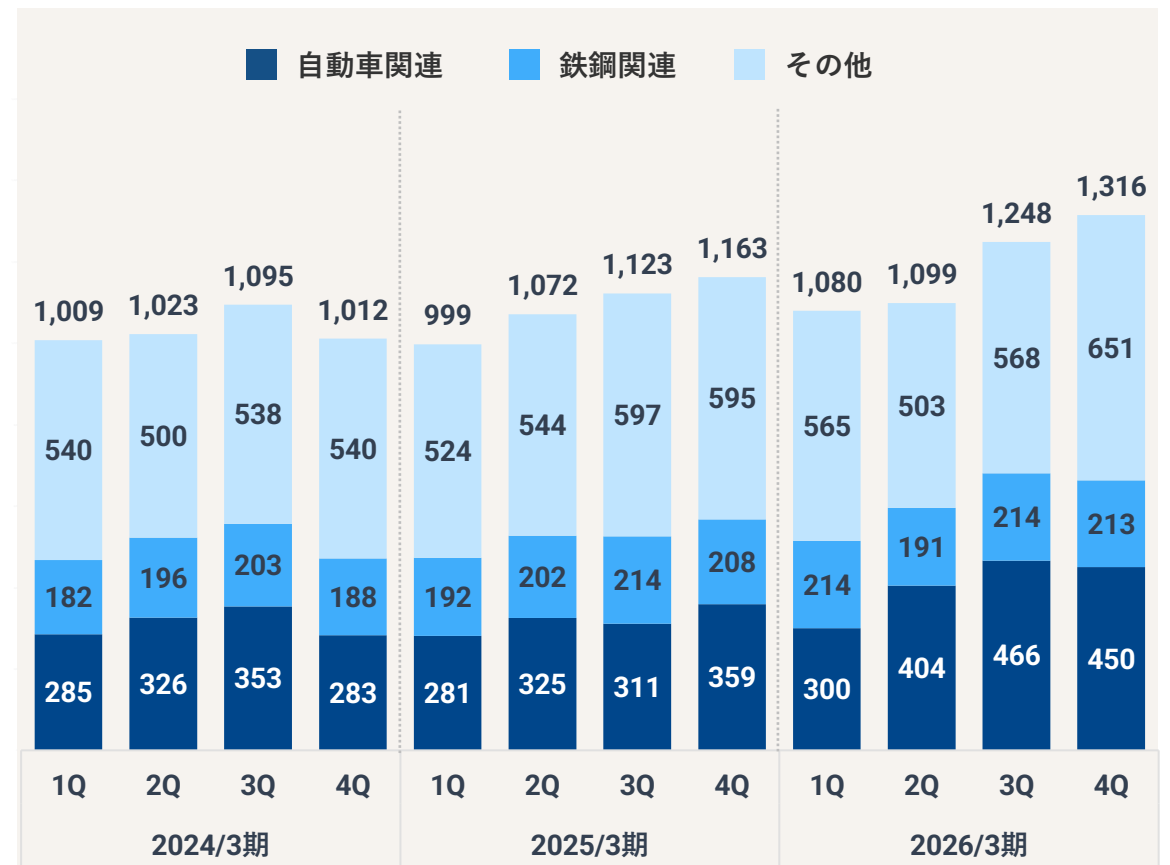
02 業績推移（製品事業内訳）

ハイテク関連製品は、AI・データセンター投資によるデータネットワーク分野が依然好調で、ハイテク関連の売上高は高水準で推移しています。光ファイバー関連については、顧客の在庫調整の影響を受け第4四半期単体では減少したものの、市場の消費量は依然として旺盛であり、引き続き好調な需要環境にあります。一方、半導体関連は顧客側の在庫調整が一段落したことに加え、予定通り装置の検収が進んだほかプローブカード用途の製品も伸長し、売上は回復基調となりました。一般研磨関連製品は、主要顧客向け出荷の増加や競合製品からの切り替えの進展等を背景に、自動車関連の売上高が順調に伸び、各用途も安定した売上を確保しています。

ハイテク関連製品（単位：百万円）



一般研磨関連製品（単位：百万円）

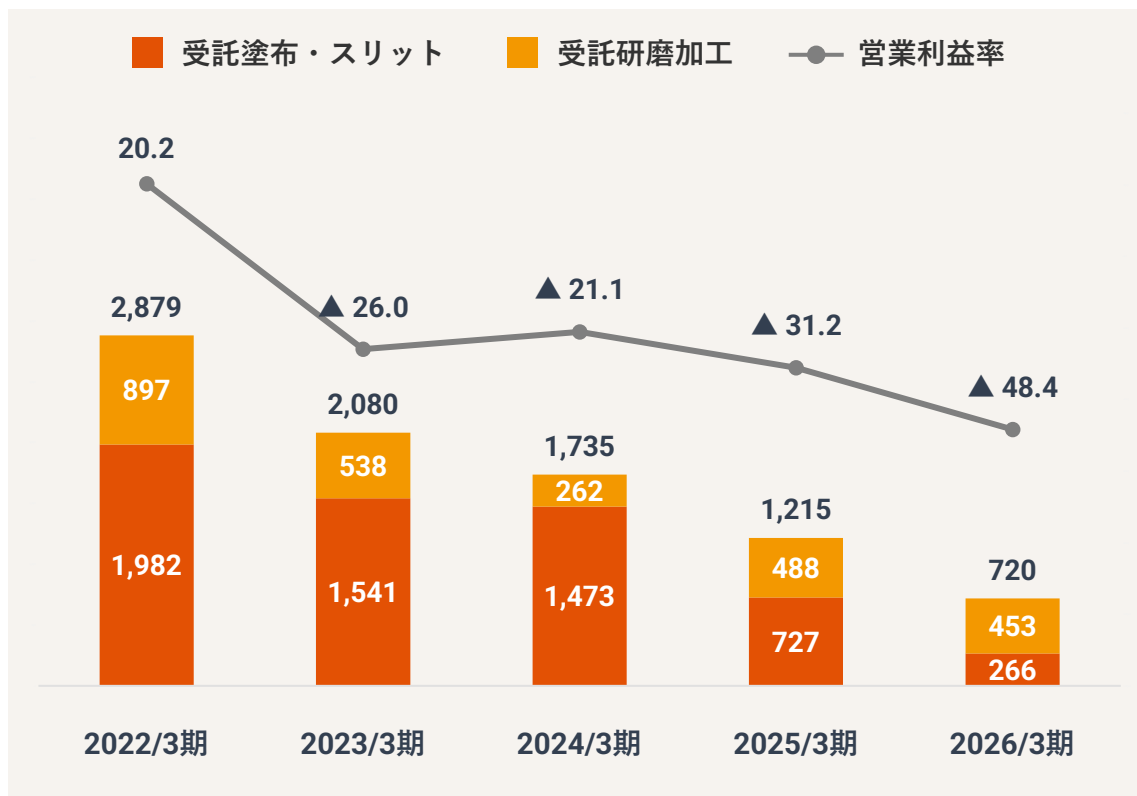


*業績数値の百万円未満の端数の扱いにより、若干の差異が生じる可能性があります。

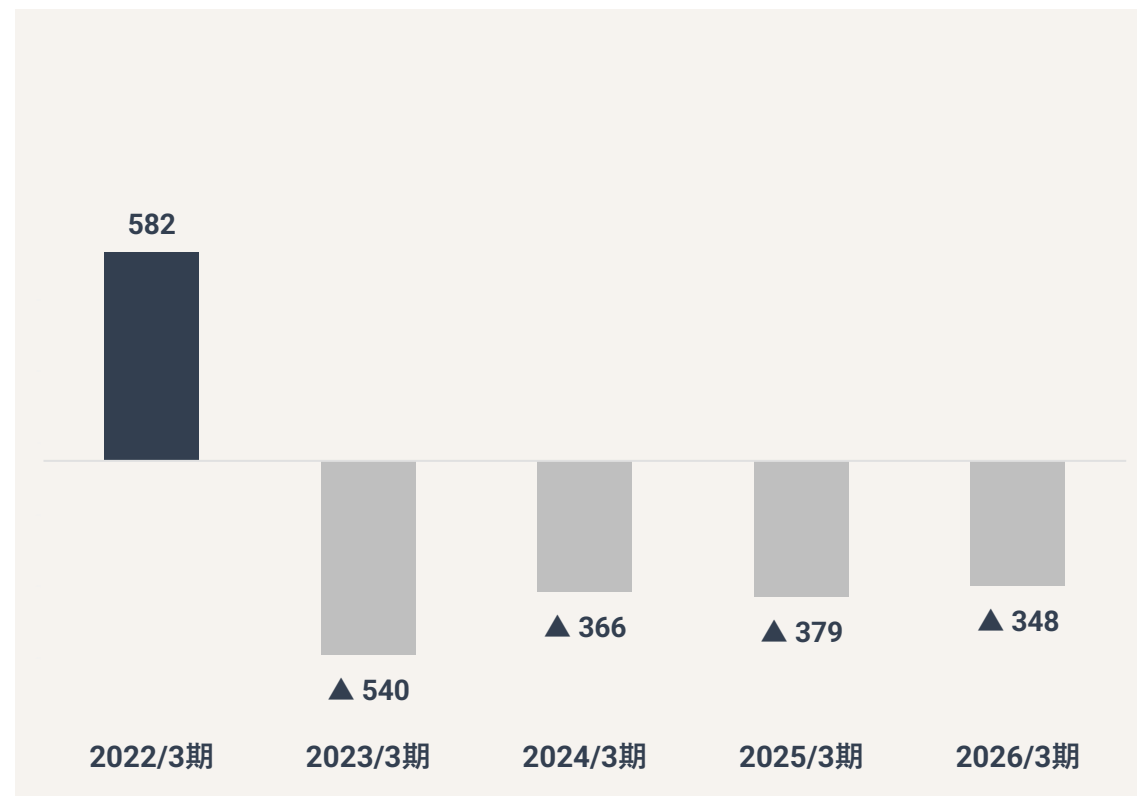
02 通期業績推移（受託事業）

売上高は低調に推移し引き続き営業損失を計上する結果となりました。営業利益は、通期を通じて案件の減少に伴う人員や設備の一部を製品事業へ活用するなど固定費の抑制に努めた結果、売上高は減少したものの損失幅は前年同期比で縮小し、減収増益となりました。

売上高・営業利益率（単位：百万円・%）



営業利益（単位：百万円）

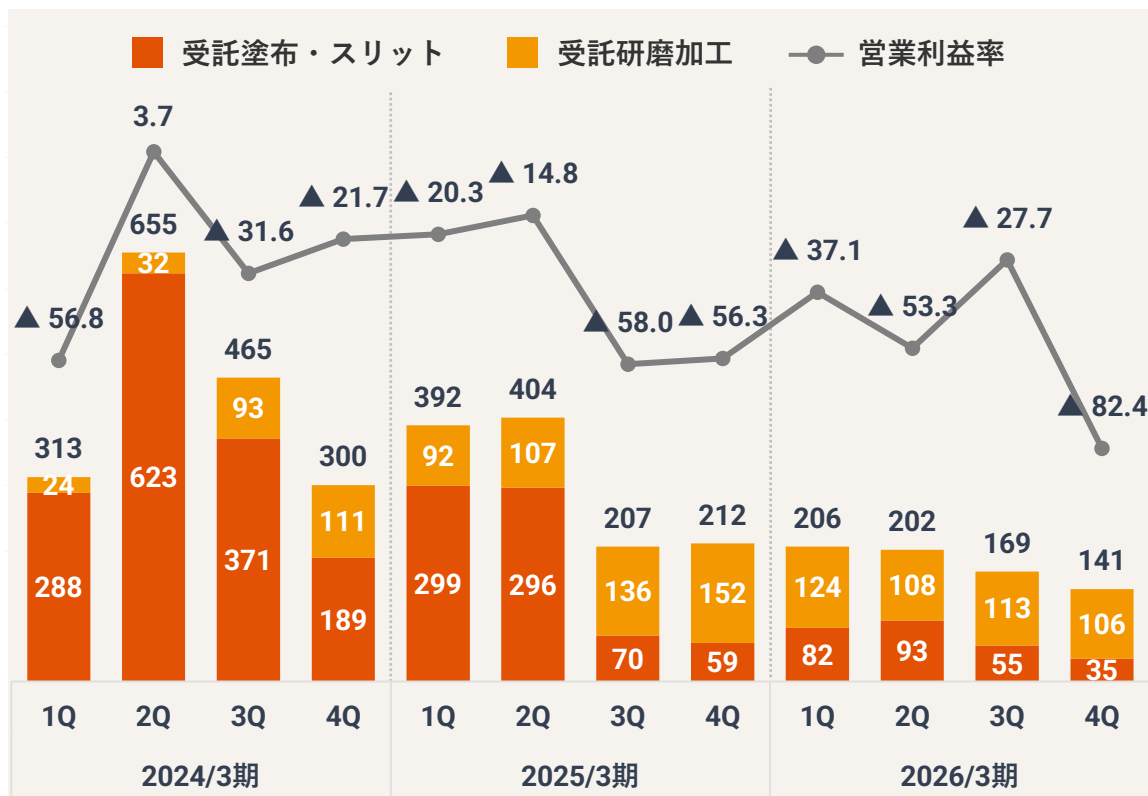


*業績数値の百万円未満の端数の扱いにより、若干の差異が生じる可能性があります。

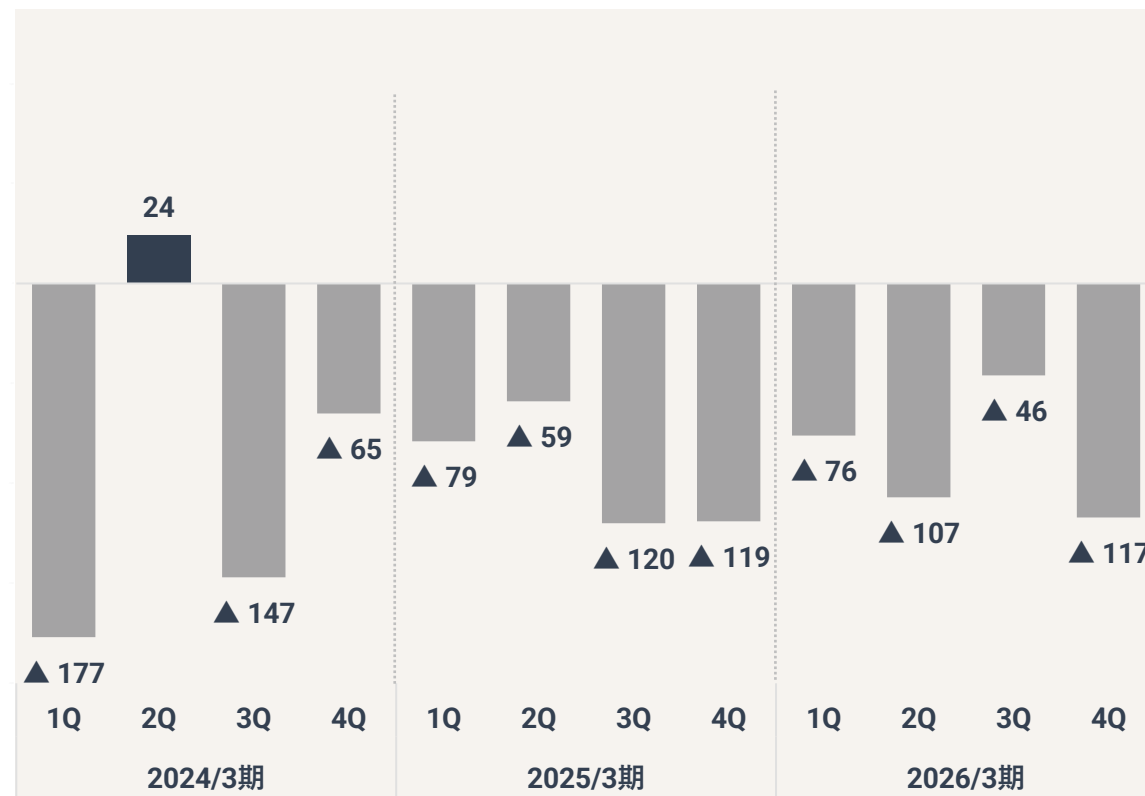
02 四半期業績推移（受託事業）

売上高は、材料費の高騰や顧客動向の変化といった市場環境の影響を受け、量産案件の減少や新規試作の獲得苦戦により低調に推移しました。利益面については、人員や設備の製品事業への転用による固定費抑制に努めたものの、案件減少に伴う共通固定費の負担増を補うには至らず、通期では損失幅は縮小したものの減収減益となりました。

売上高・営業利益率（単位：百万円・%）



営業利益（単位：百万円）



*業績数値の百万円未満の端数の扱いにより、若干の差異が生じる可能性があります。

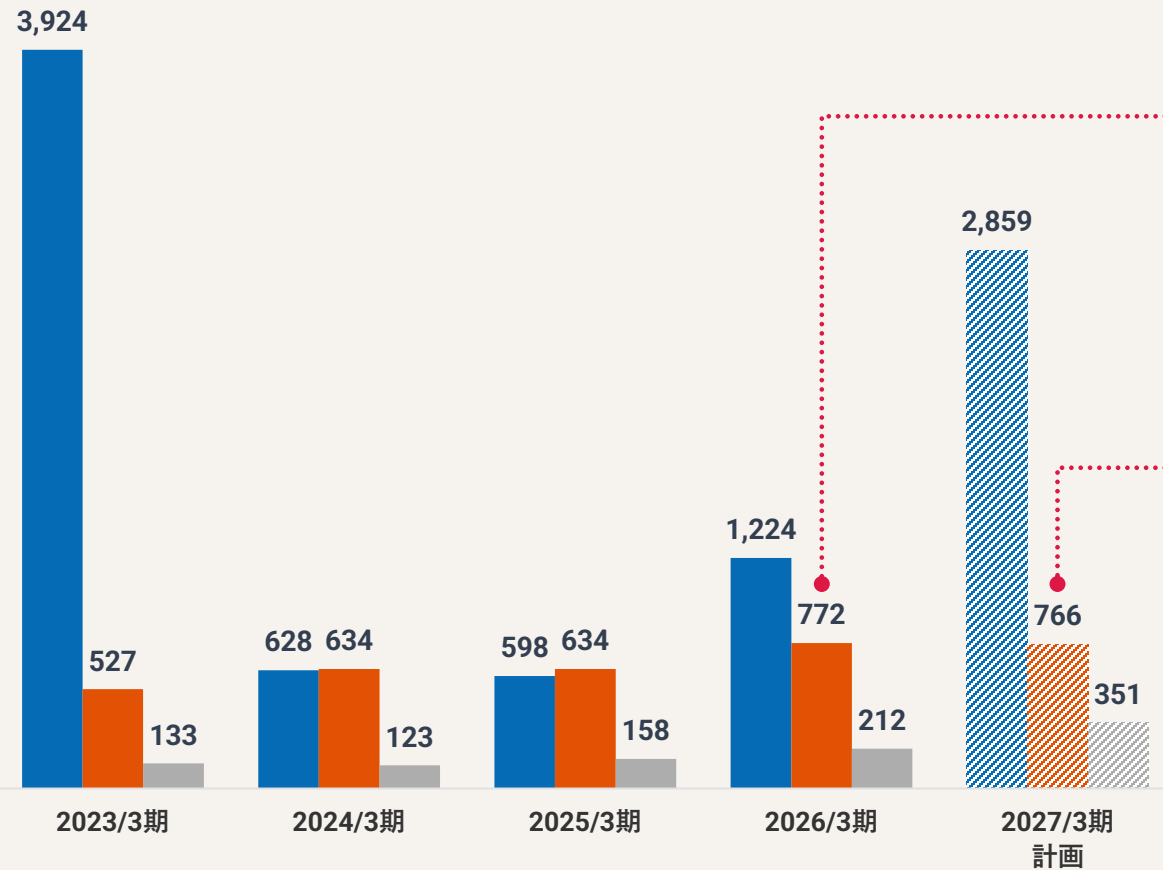
(単位：百万円)	2025/3期末	2026/3期末	増減額	備考
流動資産合計	8,465	10,388	+1,923	
現金及び預金	2,407	3,184	+777	
売上債権*	2,693	3,034	+340	下半期の売上の増加に伴う売上債権の増加
棚卸資産	2,924	3,571	+647	需要増加に伴う在庫の積み増しによる増加
その他	439	597	+157	
固定資産合計	7,465	7,680	+214	
有形固定資産	6,737	6,840	+103	
資産合計	15,931	18,069	+2,137	
流動負債合計	5,438	6,803	+1,364	
支払手形及び買掛金	945	990	+44	
短期借入金（社債含む）	3,363	4,701	+1,338	運転資金を目的とした短期借入による増加
その他	133	161	+27	
固定負債合計	2,028	2,318	+289	
長期借入金（社債含む）	1,857	1,874	+17	
負債合計	7,467	9,122	+1,654	
純資産合計	8,463	8,946	+483	
負債純資産合計	15,931	18,069	+2,137	

*売上債権は受取手形、売掛金、電子記録債権を合計し、棚卸資産は商品及び製品、仕掛品、原材料及び貯蔵品を合計しております。

*増減算出後、百万円未満切捨て

(単位：百万円)

■ 設備投資額 ■ 減価償却費 ■ 研究開発費



2026/3期の主な要因

- 【設備投資額】
 - 受託研磨関連CMP装置等の取得
 - 次世代半導体関連装置の取得
- 【研究開発費】
 - 受託研磨関連の技術開発
 - ハイテク関連製品の新製品開発

2027/3期の主な予定

- 【設備投資額】
 - 工場の自動化・省力化
 - AI関連
 - 次世代半導体関連
- 【研究開発費】
 - 次世代半導体プロジェクト関連の開発
 - ハイテク関連製品の新製品開発
 - 受託研磨関連の技術開発

リリース日	該当四半期	タイトル	詳細
2025年5月12日	1Q	商号変更及び定款の一部変更に関するお知らせ	P3 別途資料
2025年8月1日	2Q	株式会社ウジケの全株式取得に関するお知らせ	別途資料
2025年8月1日	2Q	自己株式の取得状況および取得終了に関するお知らせ (会社法第165条第2項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得)	P31 別途資料
2025年9月5日	2Q	ヴァンフォーレ甲府とスポンサーシップ締結	別途資料
2025年9月18日	2Q	九州工業大学とMipox*、半導体向け研磨フィルムの外観検査工程におけるAI自動化の実証実験を開始	別途資料
2025年10月1日	3Q	商号変更およびコーポレートロゴ刷新のお知らせ	P3 別途資料
2025年11月11日	3Q	リフレクターブランド「Ref Lite (レフライト)」新製品に関するお知らせ	別途資料
2025年11月27日	3Q	中高生と社員が共創するモノづくりプログラム「Mipox X Challenge Program」を始動	別途資料
2025年12月18日	3Q	結晶転位高速検査装置「XS-1 Sirius」の8インチウェーハ評価対応開始	別途資料
2026年3月12日	4Q	半導体ウェーハの12インチ受託加工へ本格参入、CMPラインの構築完了のお知らせ	P24 別途資料
2026年3月19日	4Q	イタリアのレーシングチーム「VSR」との戦略的パートナーシップ締結のお知らせ	P25 別途資料

*1：リリースは旧社名「Mipox株式会社」発表のもので、現在は「マイボックス株式会社」に商号変更しております。

02 半導体ウェーハの12インチ受託加工へ本格参入、CMPラインの構築完了のお知らせ (2026年3月12日)

マイボックス株式会社 2026年3月期 通期決算説明資料 (証券コード5381)

本ラインの構築により、従来の試作案件を中心とした小中口径ウェーハに加え、先端デバイス領域で需要が高まる12インチウェーハのCMP研磨加工体制を大幅に強化いたしました。さらに、「接合（ボンディング）工程」の設備拡充を並行して推進しています。



研磨から接合までを一貫して担う
「トータルファクトリーサービス」を提供

背景 デバイスの高性能化に伴う12インチCMP市場への対応

AI・デジタル社会の進展
次世代モビリティの普及

当社の超精密研磨技術

市場ニーズの高い領域

12インチウェーハ
のCMP領域

今後の展望 接合工程の拡充と3次元実装への寄与

体制確立予定

2027年3月期（来期）中

提供価値

「研磨」から「接合」までの一貫体制を構築することで、TSV（シリコン貫通電極）などを活用した次世代3次元実装への対応を可能にします。
チップの積層化など最先端のパッケージング技術を求めるお客様の課題解決に寄与いたします。

02 イタリアのレーシングチーム「VSR」との戦略的パートナーシップ締結のお知らせ (2026年3月19日)

マイボックス株式会社 2026年3月期 通期決算説明資料 (証券コード5381)

当社は、イタリアを拠点とするレーシングチーム、Vincenzo Sospiri Racing (以下、VSR) とともに、2026年の「ランボルギーニ・スーパートロフェオ・アジア・チャンピオンシップ」への参戦、および戦略的パートナーシップを締結いたしました。



Vincenzo Sospiri Racingについて

イタリアのフォルリに拠点を置く世界クラスのGTレーシングチーム
元F1ドライバーで世界チャンピオンでもあるヴィンチェンツォ・ソスピリ
によって設立・率いられる同チームは、ランボルギーニ・スクアドラ・コ
ルセ・ファミリーのベンチマーク（指標）となる存在である。

【本件の概要】

概要

2026年の「ランボルギーニ・スーパートロフェオ・アジア・チャンピオンシップ」に参戦するVSRのPro-Amクラスエントリーを全面的に支援。

業績に与える影響

本件による2026年3月期の連結業績に与える影響は軽微。

【ランボルギーニ・スーパートロフェオ・アジア 2026 開幕戦】

開催日

2026年4月25日、26日

開催地

マレーシア・セパン

チーム

VSR (パートナーシップ)

第1戦 (4月25日) の結果

- ・ プロアマクラスでエントリー
- ・ プロクラスを含む総合優勝

第2戦 (4月26日) の結果

- ・ 総合2位
- ・ プロアマクラス優勝 (クラス2連勝)

次戦の予定

2026年5月 中国・寧波 (Ningbo)

株式会社ウジケの全株式取得に関するお知らせ

2025年8月1日リリース

株式会社ウジケの全株式を取得し子会社化。ウジケが長年培ってきた塗工や圧着の技術をもとにした受託事業、バフやパッドの製品事業の継続にあたり、これまでの事業基盤を尊重しながらサービス向上を目指す。

リフレクターブランド「Ref Lite(レフライト)」
新製品に関するお知らせ

2025年11月11日リリース

日本初のリフレクター（再帰性反射布）ブランド「Ref Lite」の薄型軽量リフレクターシリーズの新たなラインアップとして、「Ref Liteウルトラライトリフレクターカラーシャインブラック」を販売開始。



ヴァンフォーレ甲府とスポンサー契約を締結

2025年9月5日リリース

山梨県内で高い知名度と地域への影響力を有するJリーグ(J2)所属の「ヴァンフォーレ甲府」とスポンサー契約を締結。地域での認知度向上やブランド浸透、採用の強化など企業価値の向上を目指す。

中高生と社員が共創するモノづくりプログラム
「Mipox X Challenge Program」を始動

2025年11月27日リリース

株式会社リバネスと、次の100年を見据えた人材の育成を目指す教育プログラム「Mipox X Challenge Program」を開始。2025年12月に開催されたサイエンスキャッスル2025で、特別企画として当プログラムを実施。

九州工業大学と半導体向け研磨フィルムの
外観検査工程におけるAI自動化実証実験を開始

2025年9月18日リリース

国立大学法人九州工業大学と、半導体用途研磨フィルムの外観検査工程を対象としたAI自動化技術の実証実験を開始。2025年3月26日に開催されたPoC（概念実証）報告会にて、その中間成果を発表。

結晶転位高速検査装置「XS-1 Sirius」の
8インチウェーハ評価対応開始

2025年12月18日リリース

半導体結晶ウェーハ内部に存在する貫通転位プロファイルを高感度かつリアルタイムに可視化する「XS-1 Sirius」において、8インチウェーハの評価対応を開始。



Agenda

01

会社概要

Company overview

02

2026年3月期
通期実績

FY2026 Full Year Financial Results

03

2027年3月期
業績見通し

FY2027 Full Year Forecast

04

事業内容

Our Business

05

競争力の源泉

Competitive Advantage

06

成長戦略

Growth Strategy

07

Appendix

Appendix

(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	親会社株主に帰属する 当期純利益
2027年3月期予想 (A)	13,000	900	900	700
2026年3月期実績 (B)	12,059	579	613	505
増減額 (B-A)	+941	+321	+286	+194
増減率	+7.8%	+55.3%	+46.6%	+38.4%

*増減算出後、百万円未満切捨て

【コメント】

- 2027年3月期は、生成AI普及によるハイテク関連製品の需要増を見込む一方、中東情勢による資源高や米国の通商政策など、不透明な外部環境に備え慎重な運営を継続します。受託事業では、CMP案件の販売増を見込む一方、試作が鈍化している塗布・スリット分野については、事業の再構成と収益構造の改善に注力してまいります。以上により、売上高は130億円を見込んでおります。
- 引き続きECを活用した販売チャネルの多様化や製造DXによる工場の自動化・省力化、AI関連の設備投資等を通じ、コストの構造的な改善を進めてまいります。また、成長戦略としてのM&Aの強化や、将来に向けた人材育成をはじめとする人的資本への投資を強化してまいります。結果、2027年3月期の営業利益は9億円を想定しています。海外売上比率の拡大に伴う為替リスクへの対応を進めつつ、経常利益は9億円、親会社株主に帰属する当期純利益は7億円を予想しております。

中東情勢の緊迫化に伴うエネルギー価格の高止まりや、原材料・物流コストの上昇など、コスト面での先行き不透明な状況は継続するものと認識しております。加えて、米中関係や通商政策、国内の政治経済動向についても、引き続き慎重な注視が必要です。

ハイテク関連製品



- 生成AI関連の投資拡大を背景に、米国を中心とした光ネットワーク向け需要は引き続き堅調に推移しております。輸送コスト面では、納期管理の徹底による船便利用の定着が進み、収益構造の安定化を図っております。
- HDD市場はクライアント向けからデータセンター向けへシフトしました。生成AIの普及に伴うデータ爆発を背景に、ニアラインHDDを中心に出荷数量もプラス成長へ回帰しています。さらに、HAMR（熱アシスト磁気記録）等の次世代技術の導入により、さらなる高精度化が加速しています。こうした市場の再成長と技術革新を追い風に、当社の研磨フィルム需要は今後も上向きに推移する見通しです。
- 半導体関連は一部の在庫調整局面を脱し、生成AI向けデバイスの増産を背景とした回復基調が鮮明となっております。プローブカードクリーニング製品等の販売は引き続き伸長する見込みです。前年度に実施した装置検収も業績の基盤となっており、今後も市場成長と共に拡大を目指してまいります。

一般研磨製品



- 中東情勢の緊迫化に伴うエネルギー価格の高止まりや、原材料・物流コストの上昇など、依然として製造コストへの圧力は継続する見通しです。このような不透明な外部環境を構造転換の機会と捉え、特定顧客・用途への依存から脱却した分散型の売上構造を構築することで、事業の安定性と耐性を高め、持続的な成長を目指してまいります。
- 新規営業拠点（仙台、鹿沼、金沢、熊本）は順調に成長しており、地域密着型営業の成果が着実に表れております。あわせて、製品価格改定も円滑に進捗しており、IT及びECサイトの活用を拡大し、デジタルと訪問営業を融合させた効率的かつ再現性の高い営業モデルを構築してまいります。
- IH事業では、これまでの試作実績とソリューション提供の経験をベースに、今後はAI・データ活用による装置イメージの明確化や、解析パターンの最適化を推進してまいります。これらデジタル技術の活用により、提案リードタイムの短縮と顧客ニーズへの即応体制を構築し、政府助成金の活用支援等も交えながら、システム導入提案をさらに加速させてまいります。

受託塗布・スリット



- 量産案件の獲得が依然として難航していることに加え、顧客側の開発予算調整等の影響により、足元の試作案件も一時的な鈍化傾向にあります。一方で、次期以降の製品化を見据えた技術相談や引き合いは着実に積み上がっており、市場ニーズに応じた事業の方向性やリソース配分の最適化を含め、慎重に検討を進めてまいります。
- 従来の半導体やディスプレイ関連に加え、新たに開始した建材関連の試作対応も継続しており、用途の多角化に向けた足掛かりを構築しつつあります。
- 今後は、潜在案件の確実な受注獲得に向けた活動を継続するとともに、事業環境の変化に即した収益構造の再構築を図ってまいります。当面は、次世代の量産案件へと繋がる試作対応を軸に据えつつ、持続可能な事業基盤の確立に向けた取り組みに注力してまいります。

受託研磨加工



- 12インチCMP案件の受託拡大に向けた設備導入および人員体制の整備が完了し、本格的な稼働体制が整いました。現在、生成AI向けメモリやパワーデバイスを中心に国内外から複数の引き合いを得ており、2027年3月期より順次収益化ステージへと移行いたします。当面は試作案件の継続を通じて将来的な量産受託への転換を図り、本格的な利益寄与を目指してまいります。
- 次世代パワーデバイス市場においては、GaN基板の8インチ化やSiC基板の12インチ化といった大口径化に伴う高難度加工ニーズが増加傾向にあります。これまでの実績を背景にリピート頻度も向上しており、最先端領域での受注獲得をさらに加速させます。また、自社製スラリーの活用や在庫確保を徹底することで、外部環境の変化に左右されない安定したサービス供給とコスト管理の両立を図ってまいります。
- 従来の研磨加工に加え、接合技術（ハイブリッドボンディング等）を組み合わせた一括受託提案により、複合基板等の高付加価値案件が着実に増加しております。製造プロセス全体をカバーする独自のファウンドリーサービスを深化させ、顧客の開発スピード向上に寄与することで、国内外での事業領域のさらなる拡大と差別化を推進してまいります。

当社は将来の事業展開と経営体質強化のために必要な内部留保を確保するとともに、株主の皆様に対しては安定配当を目指しつつ、業績等を勘案して、適正な利益還元に努めております。

配当

2027年3月期は配当については、通期業績の確定を受けての判断になりますが、期末配当10円を予定しております。

	年間配当
2025年3月期	10円
2026年3月期	10円
2027年3月期	10円 (予想)

自社株買い

資本効率の向上、及び株主還元の充実を図るため、2025年5月15日開催の取締役会における決議に基づき2025年5月16日から2025年7月31日の期間で自己株式の取得を実施いたしました。

取得株式総数	当社普通株式395,800株(上限:50万株)
株式取得総額	199,971,700円(上限:2億円)
取得期間	2025年5月16日から2025年7月31日まで
取得方法	東京証券取引所における市場買付
ご参考	2025年3月31日時点の自己株式の保有 発行済株式総数(自己株式を除く)：14,422,368株 自己株式数：29,552株

Agenda

01

会社概要

Company overview

02

2026年3月期
通期実績

FY2026 Full Year Financial Results

03

2027年3月期
業績見通し

FY2027 Full Year Forecast

04

事業内容

Our Business

05

競争力の源泉

Competitive Advantage

06

成長戦略

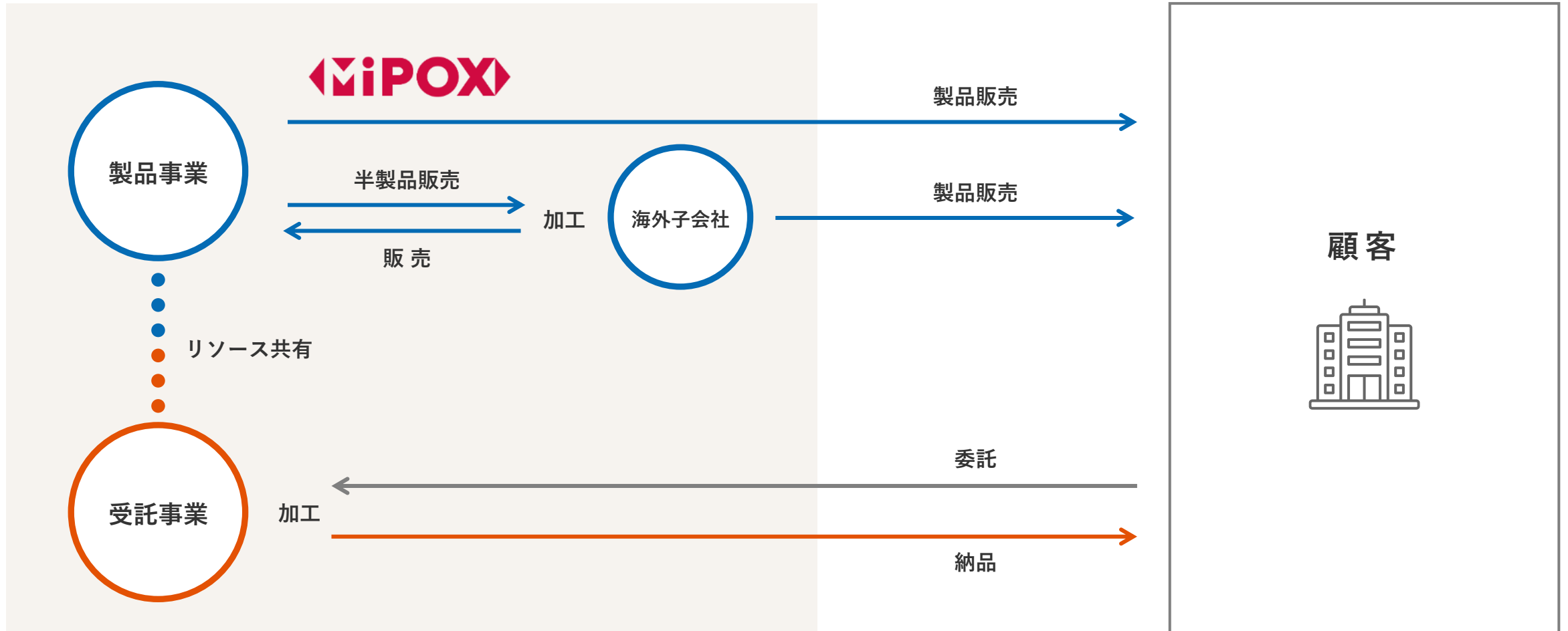
Growth Strategy

07

Appendix

Appendix

海外工場での加工を経ることにより、日本のみに工場が存在するよりも様々な製品を効率よく製造しております。海外向けに販売も行っております。顧客からの委託を受けて加工も行っており、自社製品のみならず顧客の要望に合わせたサービス・製品も提供しております。



製品事業

研磨材の開発・製造・販売を行っております。
超精密研磨から一般研磨まで、幅広いニーズに対応する製品を展開しており、装置や反射材なども含め、世界中の多様な用途に向けて提供しています。



研磨フィルム



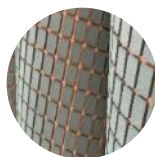
液体研磨剤



研磨関連製品



研磨布紙製品



研磨砥石製品



研磨周辺機器



検査装置



再帰性反射材
(Ref Lite)



ヤスリ製品



IH粉体塗装

受託事業

【受託研磨加工】

半導体ウェーハをはじめとする材料を顧客より預かり、当社が保有する設備（研磨装置、洗浄機、検査装置）と独自の研磨材を用いて、要望に沿った研磨加工を提供しております。

【受託コーティング・スリット】

顧客の基材（フィルム等）や塗料材を預かり、当社が保有する設備（調合、コーティング、スリット）を用いてフィルム化、裁断を行っております。



塗布製品



研磨加工



スリット加工



常温接合加工



検査

世界を磨き上げる。

世界中の産業・暮らしの中で求められる精度と品質。マイボックスは“研磨”の力で、それを静かに支えています。半導体、光ファイバー、自動車、楽器など、あらゆる分野で当社の技術が、世界のスタンダードを磨き上げています。



当社が販売する研磨関連製品例



ハイテック分野（研磨材）

ハードディスクや光ファイバー、半導体といった高精度な研磨が求められるハイテック分野向けに使用



一般研磨分野（研磨材）

航空機・船舶・自動車のボディ、楽器や建築関連の木工部品などに使用



研磨・観察装置

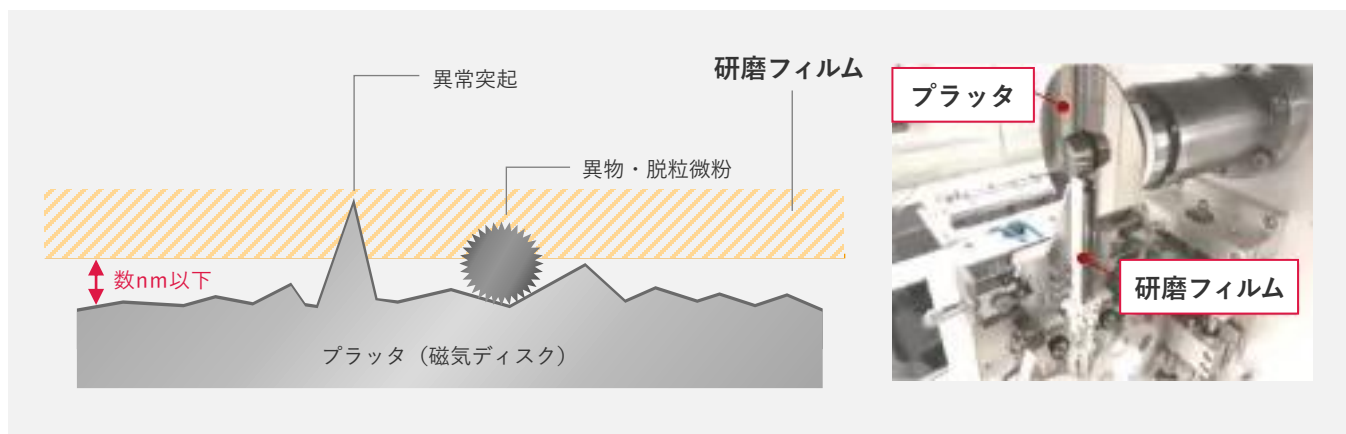
(左) エッジ研磨装置
(右) 結晶転位高感度可視化装置 XS-1 Sirius

ハードディスクドライブ (HDD) 内部のプラッタと呼ばれる磁気ディスクの表面研磨に当社製品を使用。ヘッド部に接触しないよう、1000分の1 μ m程度の突起や異物を除去します。各ハードディスクメーカーの仕様に応じたカスタマイズ製品を製造・供給しています。



ハードディスクドライブ (HDD) の研磨

当社の研磨フィルムは、独自のバインディング技術とスリット技術により、研磨フィルムから砥粒や異物がディスク上に残らないよう設計されています。この高度な技術は非常に高い難易度を誇り、他社が模倣することが難しい当社の競争力の源です。

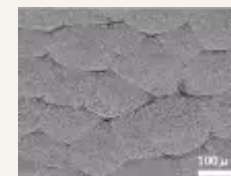


マイボックスの強み

Strength

01 カスタマイズ可能

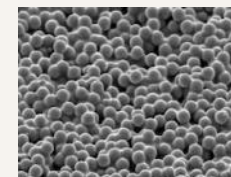
「塗る」技術の活用により、研磨層表面の形や大きさ、溝の深さ・粗さ等、各社に合わせた研磨フィルムを提案可能です。



Strength

02 球状で傷をつけない

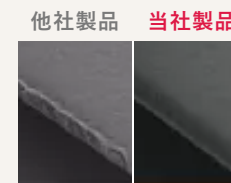
「塗る」技術の活用により、フィルムに球状の研磨材を均一に塗布。表面突起がないため、ディスクに傷をつけずに異物の除去が可能です。



Strength

03 端面まで高精度

「切る」技術の活用により、研磨フィルムの高精度な端面を実現。研磨時の傷の軽減など、品質向上に寄与しています。



ガラス製のファイバー線と、それを保持するフェルール（酸化ジルコニウム製）を研磨することで、接触面を滑らかにし、光信号の損失を最小限に抑えることができます。これにより、通信の質が向上します。先端に付着した樹脂の除去から、鏡面化までを当社の製品で行います。

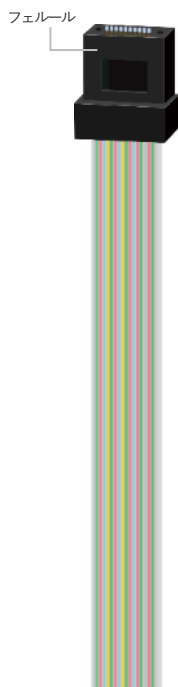
単芯タイプ 光ファイバーの研磨工程例

1本の光ファイバー線で構成。安価で長距離通信が可能。一般消費者向けネット通信（テレコム）等に使用される。



多芯タイプ 光ファイバーの研磨工程例

12~24本の光ファイバー線で構成。高価で付加価値が高い。短距離通信限定+大容量通信が可能でデータセンター等に使用される。



マイボックスの強み

Strength

01 環境負荷を低減

廃液を排出するスラリーに代わり植毛フィルムを使用することで、廃液問題の解消と環境負荷の低減を実現。環境基準が厳格な国々において、当社の製品は優位性を発揮します。

Strength

02 研磨材メーカーの製品力

研磨材メーカーとして、基材・砥粒・バインダーの多様な組み合わせにより、最適な製品を提供可能です。

Strength

03 研磨ニーズへの対応力

精密業界で培った長年のノウハウを活かし、研磨条件の最適化を提案し、様々な要求に柔軟に対応します。

半導体製造工程の中の、主に前工程であるウェーハ検査工程で使用される検査用器具「プローブカード」のクリーニングシートを提供。多くの半導体関連メーカーへの提供実績があり、幅広い製品ラインナップで、あらゆるタイプの針先クリーニングに対応いたします。



プローブカード

ウェーハ検査用「プローブカード」の針先研磨

「プローブカード」とは、半導体のウェーハ検査工程で使用される検査用器具です。プローブ針からウェーハに電気を流し、正常に動作するか検査を行います。このプローブ針の汚れのクリーニング及び先端形状の保持に、当社のクリーニングシートが使用されております。



プローブカード

プローブ針

ウェーハ

針先クリーニング前



針先クリーニング後



マイボックスの強み

Strength
01 針を摩耗せず汚れを除去

当社のクリーニングシートは針を摩耗せずに汚れの除去が可能です。高価なプローブカードの寿命を延ばすことに寄与します。



Strength
02 豊富な製品ラインナップ

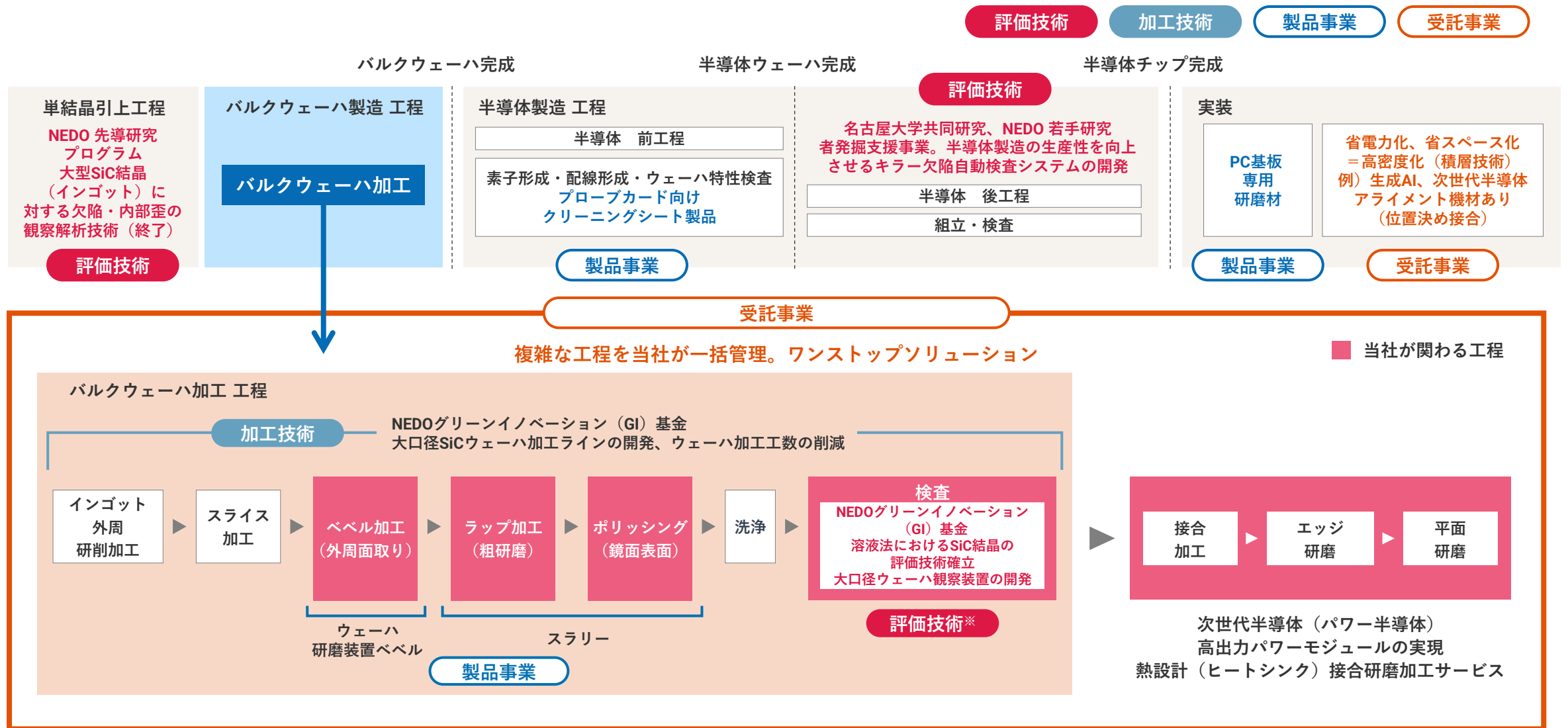
プローブ針には丸・フラット・クラウン等、様々な形状があり、それぞれの形状に合わせたクリーニング製品を提供可能です。



Strength
03 様々なテスト環境に対応

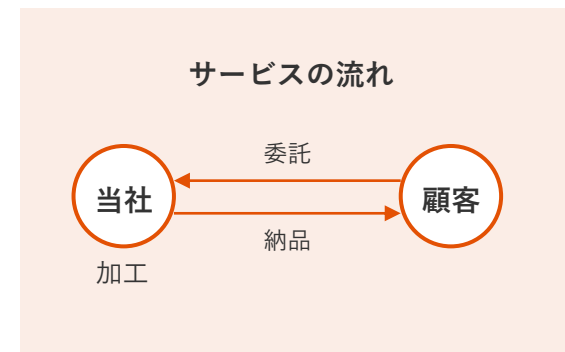
低温から高温まで、様々なテスト環境に対応した製品を取り揃えております。





*NEDOグリーンイノベーション基金での支援事業は社会実装までは利益を上げることが出来ず、収益化は社会実装後になります。

受託事業では「塗る」と「切る」の技術を主とした塗布、スリット加工のサービスと、「磨く」技術を主とした研磨加工サービスを提供しています。



塗布・スリットの製造工程（塗る・切る）

各工程は個別でも一気通貫でも対応可

調合

塗料材の配合、ミキシング、分散



コーティング

高精度の厚み制御とクリーンな環境での塗布



スリット

塗布されたフィルムを切断



検査

塗布面、切断面を各種設備で検査



機能性フィルム製造実績 （塗る・切る）

光学用粘着フィルム / 光制御フィルム / ディスプレイ向けフィルム / 半導体向けフィルム / 導電性フィルム / 化粧シート / 加飾・転写フィルム / 表示デバイス 他

研磨加工（磨く）

平面研磨（CMP）



エッジ（ノッチ）研磨加工



精密洗浄



常温接合

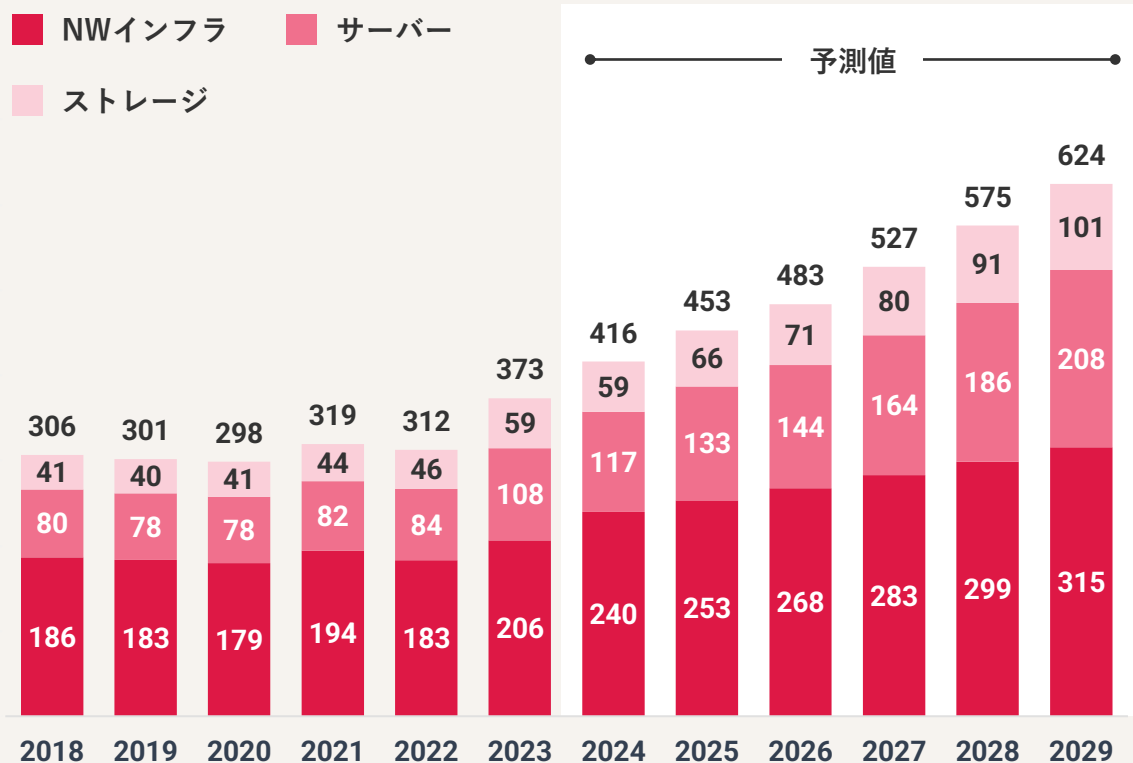


多様材料への研磨加工実績 （磨く）

半導体ウェーハ素材（シリコン / 化合物半導体〔例：GaN, SiC〕 / ファインセラミックス / 酸化物材料 / ダイヤモンド / 金属 / ガラス 等）、3Dプリント造形物 他

当社売上の約6割をデータセンター関連製品が構成し、急拡大する市場を追い風に持続的な成長を目指します。

世界のデータセンター市場規模（売上高）の推移及び予測（単位：十億ドル）



◆：総務省「令和7年版 情報通信白書」

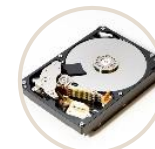
当社がデータセンターと関与する分野

サーバーの基幹部品

サーバー内部では**HDD**や半導体がデータ処理と蓄積の基盤として機能しています。



半導体



HDD

接続の要

サーバー間やネットワーク機器を繋ぐ光ファイバーは、高速・高信頼なデータ伝送を実現する上で必要不可欠な存在です。



光ファイバー

市場を牽引するネットワーク・インフラ

NWインフラはデータセンター市場において最大のシェアを誇り、高速通信への需要が市場全体を押し上げています。

Agenda

01

会社概要

Company overview

02

2026年3月期
通期実績

FY2026 Full Year Financial Results

03

2027年3月期
業績見通し

FY2027 Full Year Forecast

04

事業内容

Our Business

05

競争力の源泉

Competitive Advantage

06

成長戦略

Growth Strategy

07

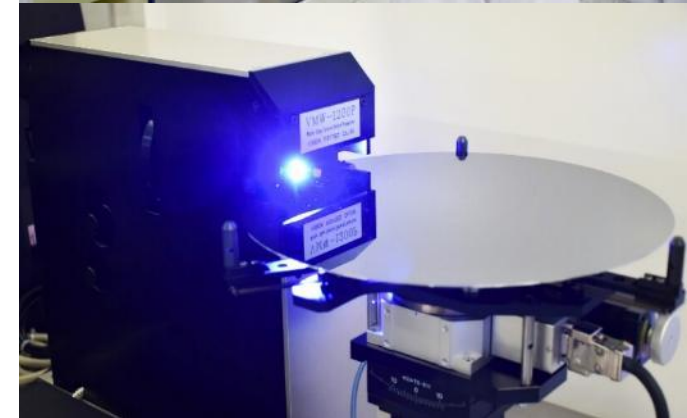
Appendix

Appendix

1 事業間で発揮されるシナジー効果

2 顧客の要望に合わせた高品質な製品の提供

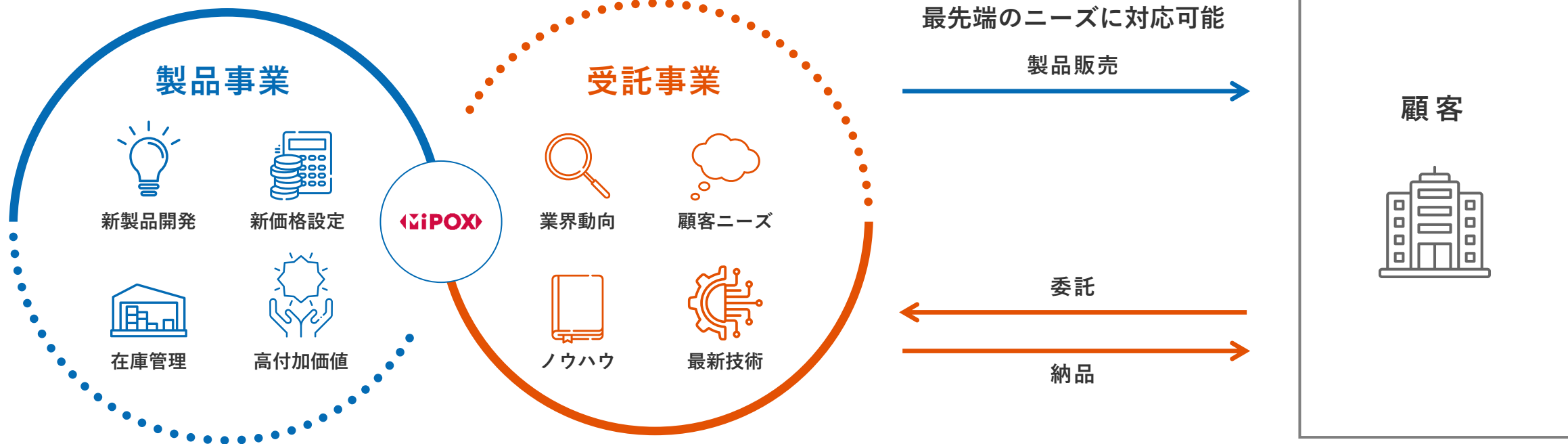
3 スマートファクトリー



製品事業と受託サービス事業では設備や人的リソースを共有しており、技術やノウハウの蓄積に役立っております。
蓄積された技術やノウハウは高付加価値のある製品やサービスの創出に活かされ、顧客の多様な要望を実現する源になっております。

製品事業と受託事業の共有型リソース

設備や人的リソースの共有



好循環成長モデルの実現

製品製造と受託加工ができるため、顧客の理想に合わせた製品の作成、きめ細やかなサービスの提供が可能です。
各製造工程において異なる取引先との煩雑なやりとりを当社がワンストップで提供しており、顧客の要望が1つの窓口で完結いたします。

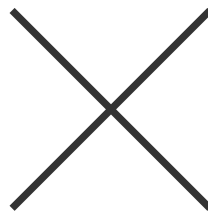
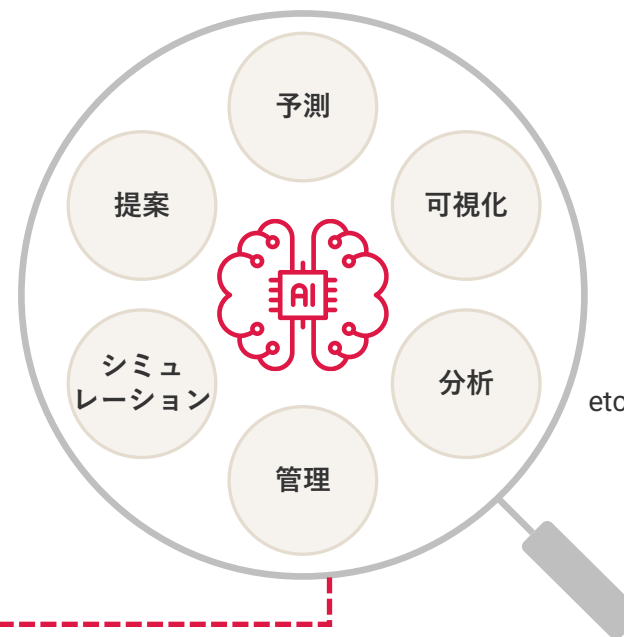


IoTとAIを活用し連携させることで、可視化しづらい部分の改善に役立つデータを収集しております。工場のDX化により、さらなる効率化・高品質化を目指します。

IoT あらゆる機器を連携させ、様々なデータを収集・蓄積



AI IoTで集めたデータを分析して課題を見える化



業務プロセスの改革

品質・生産性の向上

Agenda

01

会社概要

Company overview

02

2026年3月期
通期実績

FY2026 Full Year Financial Results

03

2027年3月期
業績見通し

FY2027 Full Year Forecast

04

事業内容

Our Business

05

競争力の源泉

Competitive Advantage

06

成長戦略

Growth Strategy

07

Appendix

Appendix

当社の株主資本コストは、ハイテク市況への高い感応度（高β）を背景として高位に推移しておりますが、高付加価値なサービスへのシフトや事業ポートフォリオの分散により、中長期的なコスト低減と収益性（ROE）の向上を同時に追求します。

ROE と株主資本コストの推移

株主資本コスト（β値）が高位に推移する要因

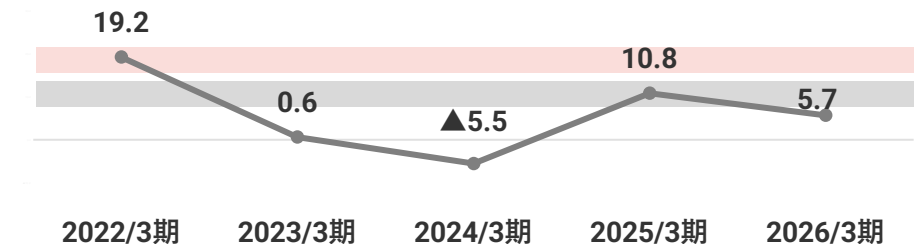
- 半導体市況の影響を受ける銘柄としての評価
- 特定のテーマ（人口ダイヤモンド等）による短期資金の流入

単位：%

● ROE

株主資本コスト

13.7~14.4%



CAPM（資本資産価格モデル）による株主資本コストの算出

$$\text{株主資本コスト} = \text{リスクフリーレート} + \text{株式}\beta \times \text{市場リスクプレミアム}$$

リスクフリーレート	+	株式β	×	市場リスクプレミアム
2.4%		2.1~2.2		5.5%

ROE の分解

ROE = 当期純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ

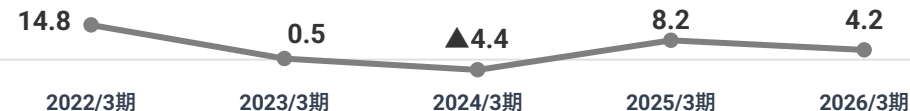
当期純利益
売上高

売上高
総資産

総資産
自己資本

当期純利益率

単位：%



総資産回転率

単位：回転



財務レバレッジ

単位：倍



投資家との対話状況

対話テーマ

※詳細な質問内容・回答はp50参照

業績動向・半導体関連市場への影響などに関心が集中



ミーティング実績

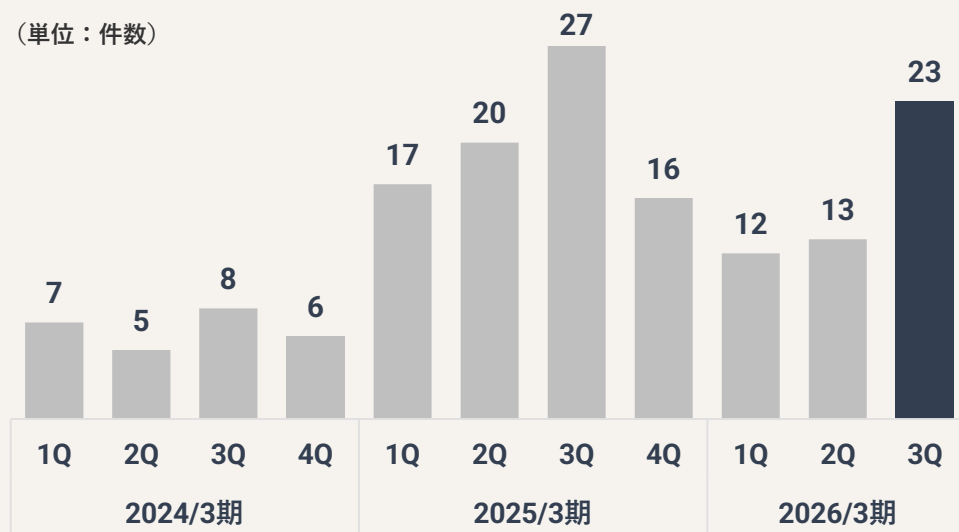
23件

2026年3月期3Q ※沈黙期間を除く

対前年同期比 △4件

投資家面談数 (決算開示後ベース)

(単位: 件数)



◆本グラフの四半期は決算期間ではなく、決算開示後の面談実施期間を示しています。

情報開示の充実



決算説明会の動画配信

半期に1度、動画をアーカイブ配信。



英語対応

決算短信・決算説明資料の英語翻訳を実施し、グローバルな情報開示体制を強化。



よくある質問

<https://www.mipox.co.jp/ir/faq/>

IR発信の媒体

X



情報提供・開示情報のお知らせ

書き起こし記事



決算説明資料の書き起こし

自社メディア



自社技術などの発信

カテゴリ	質問	回答
業績動向及び コスト構造	今期利益が計画に対し苦戦している要因は？	光ファイバー向け需要の急増に伴う納期遵守のため、航空便（エアシップ）を多用したことが主因です。これにより輸送費と関税が利益を圧迫しましたが、現在は船便への切り替えが進み、来期はこの影響はほぼ解消する見込みです。
	人件費の上昇ペースと今後の対策は？	今期はベースアップ等で一桁億円前半の増額となりましたが、これは世間並みの水準に追いつくための処置です。今後は採用抑制と自動化の推進により、総額の伸びを抑えつつ一人当たりの収入を上げる方針です。
事業別詳細 (ハイテク製品)	HDD向け製品の市場地位と状況は？	メディア製造時のテープバーニッシュ工程で世界シェア100%を維持しています。データセンター向けHDDのプラッター枚数増加が追い風となり、極めて独占的かつ高利益率な状況が続いています。
	光ファイバー向け製品の成長背景は？	AI普及によるデータセンター投資の加速が要因です。特に多芯（MT）コネクタ向け研磨フィルムが好調で、3Qの四半期売上は過去最高の10億円を記録しました。
	半導体関連（クリーニングシート）の競争環境は？	市場の注目度向上により競合が参入し、レッドオーシャン化しつつあります。車載向け高温耐性シートなどの新製品投入や既存品改良でシェア回復を図ります。
サプライチェーン 及びリスク管理	原材料費やエネルギーコスト上昇への対応は？	HDD向けなどは強気に交渉していますが、光ファイバーはシェア維持を優先し価格をキープするスタンスです。全体として不採算案件の整理や、順次価格改定を進めています。
将来の成長戦略 及び投資	受託事業を赤字でも継続する理由は？	技術習得、業界動向の把握、自社製品への固定費配分見直しという3つの戦略的理由があります。12インチCMP設備への投資により、先端デバイスの試作ニーズを取り込み、来期後半以降の収益貢献を目指します。
	今後の設備投資の方針は？	今期は約8億円ですが、来期は20億から50億円規模の投資を検討中です。人手不足に対応するため、AIやロボティクスを活用した工場の自動化・省人化体制の構築に重点を置きます。

イノベーションに 磨きをかける。

最先端を研ぎ澄ます。
次の100年を切り開き、
世界の常識を塗り替える。

01



製品・受託事業領域の拡張 (M&A戦略)

コア技術を基盤にM&Aや新技術導入を進め、塗装・研磨分野を中心に事業領域を拡大

02



カルチャー戦略

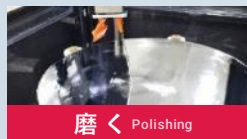
技術や設備では模倣できない「カルチャー」を競争優位の源泉とし、自律自走型の組織へ変革

03



産官学プロジェクトを通して「観る」技術の確立

NEDOプロジェクトを通じ、コア技術「観る (評価・検査)」を確立し、サービス型ビジネスへ転換



◆：鹿沼事業所の量産体制構築は完了。

「塗る・切る・磨く」を極めた技術力






コア技術を組み合わせ、お客様の成功に貢献する付加価値の高い製品とサービスを提供

当社の3つの技術ドメインである「塗る・切る・磨く」をプラットフォームとして、M&Aを重要な成長エンジンの一つとして活用し、事業拡張を進めております。






当社の技術 [塗る](#) [切る](#) [磨く](#) + [観る](#)

	項目	内訳	関連企業の買収、事業及び知的財産の継承の実績	今後の方針								
製品事業	一般研磨 関連製品	一般研磨	<table border="1"> <tr> <th>2016年</th> <th>2021年</th> <th>2022年</th> <th>2025年</th> </tr> <tr> <td>  塗る 切る 磨く </td> <td>  磨く </td> <td>  塗る 磨く </td> <td>  塗る 磨く </td> </tr> </table>	2016年	2021年	2022年	2025年	 塗る 切る 磨く	 磨く	 塗る 磨く	 塗る 磨く	<ul style="list-style-type: none"> 隣接領域へ積極展開 事業承継ニーズを成長機会に転換
		2016年	2021年	2022年	2025年							
 塗る 切る 磨く	 磨く	 塗る 磨く	 塗る 磨く									
産業分野関連												
製品事業	ハイテク 関連製品	電子部品関連		<ul style="list-style-type: none"> 当社コア技術による市場深耕 								
		先端デバイス関連										
受託事業	受託塗布・スリット	Converting Solution (製造加工)		<ul style="list-style-type: none"> 当社コア技術による市場深耕 								
	受託研磨加工	Processing Solution (研磨・洗浄加工)	<table border="1"> <tr> <th>2023年</th> </tr> <tr> <td>  磨く </td> </tr> </table>	2023年	 磨く	<ul style="list-style-type: none"> 自動化・無人化で収益力を向上 						
		2023年										
 磨く												
先端デバイス関連												
		Evaluation Solution (観察・検査・評価)	<table border="1"> <tr> <th>2018年</th> </tr> <tr> <td>  観る ◆現在は閉鎖 </td> </tr> </table>	2018年	 観る ◆現在は閉鎖	<ul style="list-style-type: none"> 新たな技術ドメイン「観る」の確立へ 						
2018年												
 観る ◆現在は閉鎖												
	市場開発・技術開発		<table border="1"> <tr> <th>2015年</th> <th>2023年</th> </tr> <tr> <td>  塗る </td> <td>  塗る </td> </tr> </table>	2015年	2023年	 塗る	 塗る	<ul style="list-style-type: none"> 買収技術と自社技術を掛け合わせ新技術を創出 				
2015年	2023年											
 塗る	 塗る											

単なる事業拡大のためのM&Aではなく、後継者不足や人手不足という日本製造業の構造的課題を成長機会に転換する、「業界再編」としてのM&Aを推進します。

製造業を取り巻く社会課題		当社の競争優位性 -再現性のあるPMIによる価値創出-		
 後継者不在率*1 42.4%	 製造業の社長平均年齢*2 61.6歳	 PMI標準化 統一プロセスにより 立ち上げ期間を短縮	 デジタル基盤の導入 業務効率化・可視化 により生産性を向上	 組織・カルチャー変革 働き方改革・環境整備により 人材定着・採用力を強化
事業継承ニーズは今後も継続的に発生		構造課題を解決しながら企業価値を向上		

標準化されたPMIプロセスによる企業再構築

- 課題企業の買収**

 後継者不在・人手不足
 企業を受け入れ
- 初期統合**

 業務・組織の
 可視化と課題抽出
- 組織環境の再構築**

 働き方・オフィス環境の
 改善により組織力を強化
- オペレーション改革**

 デジタル導入により
 業務効率と生産性を改善
- 技術シナジーの創出**

 取得技術と既存技術を融合し
 新製品・新領域を創出

企業再構築を通じて、収益成長と持続的な競争力を実現

*1: 帝国データバンク「全国『後継者不在率』動向調査 (2025年)」 *2: 帝国データバンク「全国『社長年齢』分析調査 (2025年)」

当社のコア技術の一つである「塗る」に関連する技術であるIH（高波誘導加熱）技術を利用し事業展開を図ります。鹿沼事業所に開設した実証実験ラボの積極的な活用に加えて、IH技術を活用した自社製品の開発に向けて設備の導入を進めています。

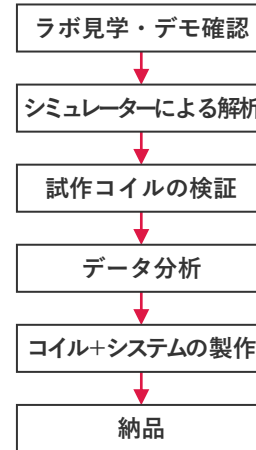
【実証実験ラボのIH粉体塗装システム】

特許取得済（特許第7560971号）



実証実験ラボ見学の様子

2023年3月に譲り受けた株式会社スガ コーディングスのIHを活用したコーティングラインの企画・設計・開発・販売を展開し、溶剤不使用のコーティング技術の導入支援を行っています。2023年10月に鹿沼事業所に開設した実証実験ラボを積極的に活用しながら、製造工程の中で最もエネルギーを要する設備であるガス熱風乾燥炉を、IHを利用した電気加熱方式であるIH設備に置き換えることによって省エネ、省スペースを実現できる塗装工程ラインをご提案しております。



ラボで事前検証が可能に

新技術に対する顧客の不安を払拭し、スムーズなシステム導入に寄与

IH粉体塗装技術の活用体制強化



福山事業所に加え、北杜事業所でもIH粉体塗装システムの導入を進め、実証実験ラボや各事業所で得られた技術・ノウハウを活用して自社製品の開発を進めてまいります。



IH粉体塗装技術で製造した研磨製品

技術や設備は模倣できても、カルチャー（文化）は模倣できない。

15年にわたるDXへの継続投資、リブランディング、M&A、そして戦略的な知財管理を以て、管理型から自律自走型の経営を目指します。



リブランディング

100年企業の「脱皮」

01

物理的環境の刷新

M&A後まず、オフィスのリノベーションやカフェテリアの設置に着手。オープンレイアウトが心理的な壁を取り払い、情報流動性と透明性を高める。

ロゴ刷新の意思

100周年を機に刷新。製造業の慣習や固定観念から意図的にはみ出す「スジの通ったはみ出し者」として、業界の常識を塗り替える決意を示す。

デジタル・ファースト

文化と仕組みの双方向インストール

02

共通言語化

SalesforceやGoogle Workspaceを全社員の「共通言語」として導入。拠点や世代を超えた透明性の高いコミュニケーション基盤を構築。

情報の民主化とAIによる自律自走の最大化

現場も経営層も同じデータにアクセスできる環境を構築。生成AIと掛け合わせ、誰もが熟練の知恵を武器に戦える自律分散型組織を実現。

カルチャー・プラグイン

PMIの型でM&Aを高速化

03

文化の書き換え

リアルワークプレイスとデジタルワークプレイスをセットで刷新し、買収先の「古い慣習」を「マイボックス流」へ一気にアップデート。

救済型M&A

後継者不在やデジタル化に悩む企業に対し、「技術と雇用を守るプラットフォーム」としての安心感を提供。社会的価値と利益追求を両立。

3つのNEDO（国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構）プロジェクトへの参画（うち2つは終了）を通じ、次世代の成長基盤となる知的財産とノウハウの蓄積に注力しております。技術ドメインである「塗る・切る・磨く」に「観る」を新たな領域として確立することで、技術基盤のさらなる高度化を図ってまいります。

PROJECT 01

NEDOグリーンイノベーション基金事業 —次世代デジタルインフラの構築—

オキサイドを幹事会社として（株）UJ-Crystal、国立大学法人東海国立大学機構名古屋大学、アイクリスタル株式会社、国立研究開発法人産業技術総合研究所が参画

- 前年度は、2年間の委託事業を当初想定通りの成果で終了し、助成期間へ移行。パイロットライン各装置の立ち上げ、工数削減、シミュレーション技術の構築、及び検査装置の量産化検討を実施した
- 今期は、結晶転位高速検査装置「XS-1 Sirius」において、8インチウェーハ評価対応を開始した

加工技術

大口径SiCウェーハ加工ラインの開発

8インチ対応SiCウェーハ加工、パイロットラインの構築

ウェーハ加工工数の削減

加工シミュレーションの検討と削減工程候補の抽出

評価技術

溶液法におけるSiC結晶の評価技術確立

溶液法SiCに適した光学系の最適化とそれに基づく装置設計

大口径ウェーハ観察装置の開発

8インチウェーハに対応した装置使用の検討と設計

2024年度末 終了

NEDO官民による 若手研究者発掘支援事業

名古屋大学（原田俊太准教授）

評価技術

半導体製造の生産性を向上させるキラー欠陥自動検査システムの開発

2023年8月論文発表

パワーデバイスSiCウエハの偏光観察による結晶欠陥評価技術

2024年11月論文発表 2025年3月論文発表

2022年度末 終了

NEDOマテリアル革新技術 先導研究プログラム

電力中央研究所・名古屋大学（宇治原徹教授）・理化学研究所

評価技術

大型SiC結晶に対する欠陥・内部歪の観察解析技術

SiCインゴット検査装置の開発

名古屋大学と製品化に向けた 研究開発を継続

当社のコア技術 Technology + Estimation

切る

塗る

磨く

観る

NEW

カーボンニュートラルの実現に向けてエネルギー構造や産業構造の転換、大胆な投資によるイノベーションの創出が必要とされています。これまでの社会の延長にない飛躍的な目標を達成するため創出された、グリーンイノベーション基金のプロジェクトに当社が参画しております。

【NEDO※1グリーンイノベーション基金】

- ・ 日本政府が主導する「2050年カーボンニュートラル」宣言を達成するための基金
- ・ 事業予算2兆円
- ・ カーボンニュートラルに向けた研究開発、実証から社会実装に取り組む企業に最長10年間支援

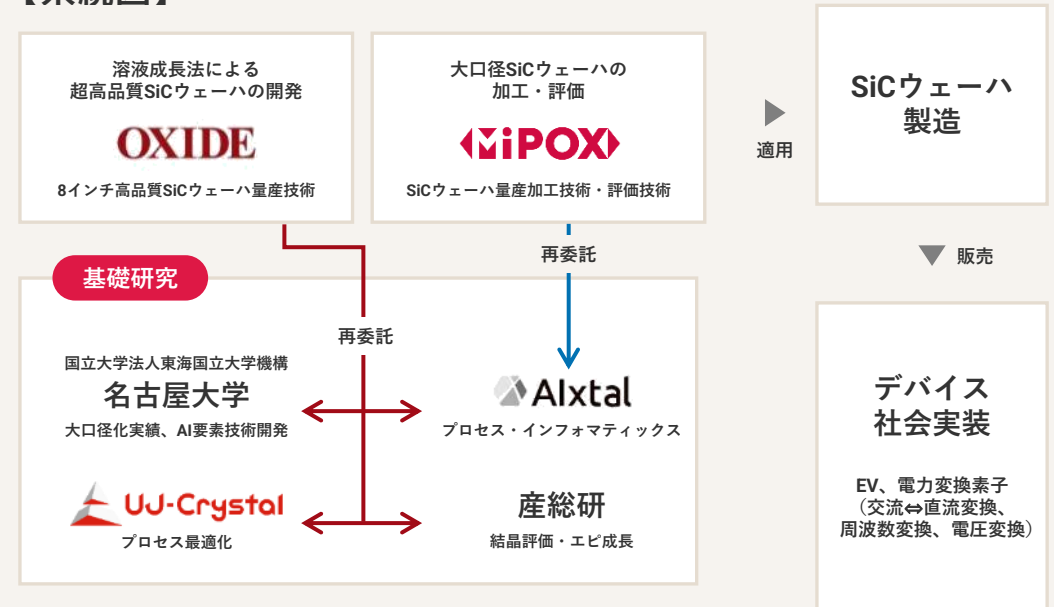


※1：国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構

【プロジェクトの目的】

超高品質・8インチ・低コストSiCウェーハ開発・販売

【系統図】



Agenda

01

会社概要

Company overview

02

2026年3月期
通期実績

FY2026 Full Year Financial Results

03

2027年3月期
業績見通し

FY2027 Full Year Forecast

04

事業内容

Our Business

05

競争力の源泉

Competitive Advantage

06

成長戦略

Growth Strategy

07

Appendix

Appendix

01



代表取締役社長 渡邊 淳 WATANABE Jun

日本とアメリカの大学で学んだ後、1994年当社へ入社。製造現場でキャリアをスタートし、生産技術、国内営業、海外営業を担当後マレーシア駐在員、米国子会社赴任を経験。その後半導体部門長、海外支援部門長に従事。2007年取締役、2008年に先代から引き継ぐ形で現職に就任。就任後は不採算事業撤退や拠点の統廃合を通して赤字からの脱却を行った。業績回復後は製造業として「技術・品質」に加え、デジタルを企業変革の柱と据えてIT推進をリード。

02



取締役 中川 健二 NAKAGAWA Kenji

全自動水洗い洗濯機や半導体CMP後洗浄装置の開発、ハードディスクメディアむけ研磨テープや光学検査装置の技術営業を経験。独立後は光学検査装置のマーケティングから技術、営業や貿易などに携わる。2002年に独立後、2016年当社技術本部長、2019年経営企画部長兼経営管理部長に就任。経営全般に関わりながら、社内組織体制の構築やレフライトのブランディング活動に注力。2021年から新事業開発に携わり、GI基金の大口径SiCウェーハの加工開発を統括している。

03



取締役 上谷 宗久 UETANI Munehisa

2000年に当社入社。台湾支店長や海外子会社の代表取締役を経て、2012年取締役営業本部長に就任。製造拠点の運営、競合他社とのM&A、そして民事再生を経た企業の事業承継等を担当。2017年に退職し、ITベンチャーにおける取締役COOとしての経験をはじめ、エンジニアリング企業での事業開発責任者としての役職を経た後に、2022年4月に当社に復帰。外部活動としてthomas株式会社の社外取締役も務める。

04



社外取締役(独立役員) 加藤 洋美 KATO Hiromi

2007年12月に弁護士登録をし、日比谷法律事務所に入所。以降、法律業務に従事し、2021年4月には同事務所の所長に就任。現在も所長として業務を遂行中。また、2021年4月からは小岩井農牧株式会社の監査役を務めており、2023年4月には株式会社小岩井ファームダイニングの監査役にも就任し、同様に現任している。

05



社外取締役(独立役員) 宮崎 健輔 MIYAZAKI Kensuke

大学卒業後、外資系半導体製品を販売する専門商社に入社し、法人技術営業、全社プロジェクトのリーダー、海外研修、部門立ち上げなどを経験。その後、日本最大のMBAスクールを有する企業グループに転職し、経営大学院にてMBAを取得。法人営業部門のチームリーダー、コンサルタントを務めた。独立後は、経営コンサルタント、エグゼクティブコーチ、組織開発、企業研修などを手がけ、現在も事業・組織領域の両面において幅広く活動を続けている。経営者へのコーチングも行っており、人的資本経営の専門家として、企業の成長支援に注力している。

	経営全般	グローバル経営	ESG	DX戦略	研究・技術開発	M&A	マーケティング・営業	製造・生産技術	法務・リスクマネジメント	人材戦略
01  代表取締役社長 渡邊 淳	●	●	●	●		●		●		
02  取締役 中川 健二					●		●	●		
03  取締役 上谷 宗久		●		●		●	●			
04  社外取締役（独立役員） 加藤 洋美									●	
05  社外取締役（独立役員） 宮崎 健輔			●							●

人的資本の充実に向けた取り組みの一環として、従業員のウェルビーイングに関する社内アンケートを実施



目的と位置づけ

- 社員のエンゲージメントや心理的状态を可視化し、離職・休職を未然に防ぐ
- 単なる「負担軽減」ではなく、納得感・共感度の向上を目指す



特徴と現状

- 予防的要素が強く、将来的な向上に重点
- 回答率は9割超と高水準 → 社員の関心度の高さを示す
- ウェルビーイングスコアは6.1/10点 (2026年3月末現在)



今後の方針

- 現状は、「数値の意味づけ」と「目標の明確化」に向けた段階
- 現時点では事実ベースで開示し、改善策を検討中
- 将来的に、定点観測と改善サイクルの確立を目指す



アンケート回答率 **99%**以上

数か月で常識が塗り変わる現代において、当社は共通の判断軸に基づく「自律型組織」を構築しています。
現場一人ひとりが即断即決できるカルチャーを競争優位性とし、圧倒的な対応力と実行スピードで市場をリードします。



コンパスの策定

- 行動指針を明文化し、全社員が共有する判断軸として活用
- 毎日の朝礼で確認・共有し環境変化を踏まえ、定期的なアップデートを実施



カルチャーを支える仕組み

- コミュニケーションツールを活用したオープンな情報共有と、判断プロセスの可視化
- 役職に依存しないフラットなコミュニケーション設計
- AIを現場の意思決定・業務改善に活用する運用
- 判断と対話が生まれやすいオフィス・働き方設計



自律的な意思決定

- 現場が自ら考え判断し、行動することを前提とした組織運営
- コンパスを共通言語とすることで、判断の方向性を揃えたまま意思決定を分散
- 経営は指示を出すのではなく、自律的な判断を支える環境整備に注力

当社では、次世代を担う人材の育成と長期的なキャリア形成を重視しています。そのため、以下のような多様な取り組みを行っています。

採用や育成に関する取り組み

【工場見学及びインターンシップ】

高校生を対象に工場見学やインターンシップを実施し、職業体験を通じて実際の業務を理解してもらう機会を提供しています。これにより、若い世代の興味を引き出し、将来の採用につなげています。

【OJT教育と研修制度】

当社の教育プログラムはOJT（オン・ザ・ジョブ・トレーニング）を中心に構成されています。新入社員は現場での実務経験を積むことで、実践的なスキルを身につけます。また、各部署やキャリアパスに応じてフォローアップ研修を行い、継続的な成長を支援しています。具体的な研修内容としては、入社時研修、拠点間研修、ビジネススキル研修（外部研修）などがあります。

【新卒定着率】

当社の**新卒定着率***は**64.7%**に留まっており、現在、採用・配属プロセスの最適化に着手しております。具体的には、学生との接点強化に加え、入社後の実務体験を通じた適性把握と相互理解の深化に注力しています。これらによりミスマッチを抑制し、長期的に活躍できる支援体制の構築を推進してまいります。

【まなび支援制度】

・まなび×応援（若手のリスキリング）

働きながら大学で学びたい若手社員を支援します。専攻は自由で、個人の意欲的な挑戦を後押しします。

・まなび×ミッション（次世代リーダー育成）

選抜メンバーを対象に、国内外の大学院やMBA取得などの高度教育を支援します。将来の経営を担うための専門性や語学力を習得します。



新卒定着率 **64.7%**

※過去5年採用新卒定着率。国内データに基づく。

※2026年3月末現在

当社では、従業員一人ひとりが最大限のパフォーマンスを発揮できるよう、柔軟で多様な働き方を推進しています。



平均残業時間

11~15時間/月

男性育休取得率 62.5%

働き方に関する取り組み

【在宅勤務とスーパーフレックス制度】

働く場所や時間に柔軟性を持たせることで、従業員が自身のライフスタイルに合わせた働き方を選択できるようにしています。

【ハレアワー制度】

社員がリフレッシュし、仲間との絆を深めるために、時間単位で取得できる休暇制度です。具体的な活動例としては、部や課の全員でプロスポーツの応援に行く、花見や暑気払いを行う、打ち合わせ後に全員でボーリングに行くなどが含まれます。この制度は社員全員がリフレッシュし、良好な人間関係を築くことを目的としています。

【地域貢献活動】

小中学生を対象とした「研磨加工教室」の開催や定期的な公園美化活動の実施等を通して、地域社会への貢献を大切にしています。

【社内行事】

当社が大切にしている『みんな仲良く』の精神を実現するため、また「働き方改革」の一環として、社内行事を積極的に実施しています。これにより、社員間のコミュニケーションが深まり、より良いチームワークが築かれています。

【残業時間の管理】

当社の従業員の**平均残業時間は月11~15時間***を推移しています。具体的な目標数値は持っていませんが、バランスの取れた働き方を重視しています。

【有給休暇取得率】

有給取得率の**目標を80%**と設定しており、現状では**93.3%***です。これにより、従業員のワークライフバランス向上を図っています。また、**男性育休取得率は62.5%***となっております。

当社では、従業員のエンゲージメントを高め、働きがいのある職場環境を実現するために、以下の取り組みを行っています。

エンゲージメントに関する取り組み

【COMPASSの作成】

当社の指針となる「COMPASS」を作成し、全従業員に共有しています。この指針は、企業理念やビジョン、行動指針を明確にし、従業員が日々の業務において共通の目標と価値観を持つための基盤となっています。

【定期的なアンケートの実施】

従業員の声を直接反映させるために、定期的に従業員サーベイ（ウェルビーイングサーベイ）を実施しています。このアンケートでは、従業員の満足度や不満点を収集し、それに基づいた具体的な対策を講じています。従業員の意見を積極的に取り入れることで、働きやすい環境の整備とエンゲージメント向上を図っています。

これらの取り組みの結果として、当社の**退職率は9.8%（グローバル）**となっており、従業員が長く安心して働ける環境が整っています。これからも、従業員の声を大切に、エンゲージメント向上に努めてまいります。



退職率 **9.8%**

当社では、安全と適正を最優先に考え、職場環境の最適化に向けた取り組みを積極的に行っています。



5S活動

健康・安全に関する取り組み

【5S活動】

5つの要素からなる5S活動を推進しています。これにより、職場の安全性を向上させ、効率的な作業環境を整えています。

【5Sとは】

- 整理** Seiri : いらぬものを捨てる
- 整頓** Seiton : 決められたものを決められた場所に置き、取り出せる状態にしておく
- 清掃** Seisou : 常に掃除する
- 清潔** Seiketsu : 3S（整理、整頓、清掃）を維持し、職場の衛生を保つ
- 躰** Shitsuke : 決められたルールを守る、手順を正しく守る、習慣をつける

当社は生産性向上のための業務効率化を行っています。安全性、快適性の高い工場を目指し、決められたルールを当たり前を守る風土を作り、会社の信用度、会社の利益に繋がります。安全で安心して働ける職場環境の維持と向上に努めています。

当社では、多様性を尊重し、誰もが活躍できる職場環境の実現に向けた取り組みを進めています。

ダイバーシティに関する取り組み

【男女別従業員比率】

従業員比率は**男性：女性が3.7：1（グローバル）**となっています。これに対して、女性の採用や昇進の機会を増やす取り組みを進めています。

【男女別賃金格差】

男女間の賃金格差は61.9%（国内のみ）です。なお、属性（勤続年数、役職等）が同じ男女労働者間での賃金の差異はありません。

【女性管理職比率】

女性管理職比率は11.2%（グローバル）です。女性リーダーの育成プログラムやメンター制度を導入し、女性が管理職として活躍できる環境作りを推進しています。

【障がい者雇用比率】

障がい者雇用比率は2.3%（国内のみ）であり、目標の2.7%に向けて取り組んでいます。職場のバリアフリー化や障がい者向けの職務設計を進めることで、働きやすい環境を整備しています。



男女間の賃金格差 **61.9%**

女性管理職比率 **11.2%**

障がい者雇用比率 **2.3%**

Environment



- 太陽光パネル導入の推進
- IH粉体塗装システム
- RTOの利用によるVOC削減
- LNGボイラの導入
- リサイクル素材を使用した製品の開発
- グリーンイノベーションへの取り組み
- ISO14001 にもとづいた環境負荷軽減

Social

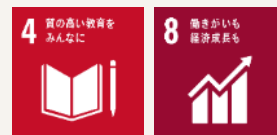


- Eラーニングによる社内教育の充実
- スーパーフレックスタイムの導入
- 人事評価システムの構築
- 資格取得の促進及び取得後の手当の充実
- 労働災害事故の防止
- 若手の定着率の向上
- 女性従業員比率の向上

Governance



- 透明性のある情報開示
- 内部通報窓口を外部企業に委託
- 全社員に対するコンプライアンス研修の実施
- グループ各社に対するガバナンスとモニタリング体制の強化



● 工場/オフィス ● 営業拠点 ● サテライトラボ



IRお問い合わせ

フェアディスクロージャーの観点から、公平な情報開示体制と株主様と投資家の皆様へのお問合せ対応の維持を考慮し、IRお問い合わせ窓口のお電話での対応をおこなっておりません。HPのお問い合わせフォームをご利用ください。

お問い合わせはこちら >

<https://www.mipox.co.jp/inquiry.html>

